

2021年3月期 第2四半期決算説明会

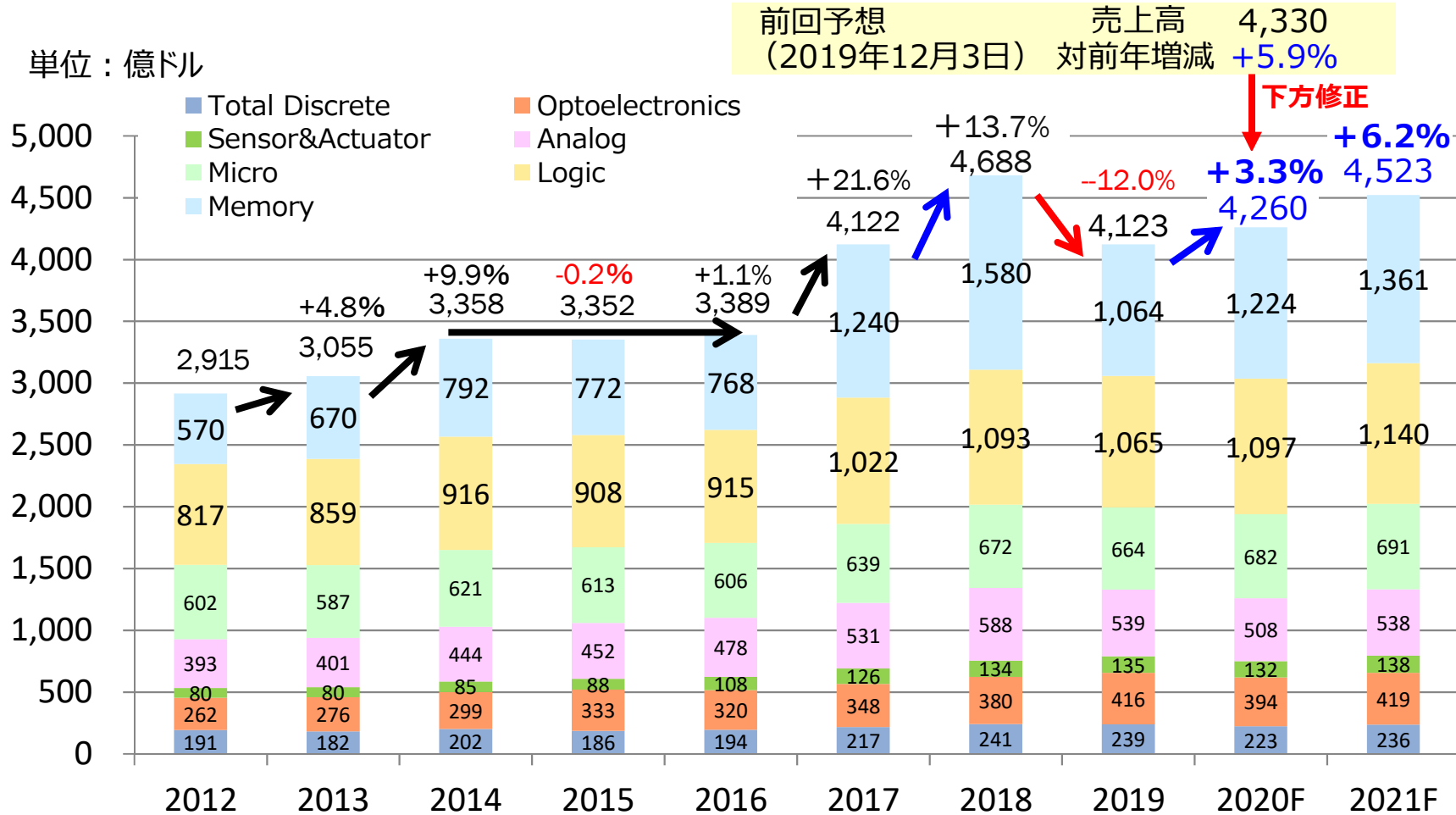
2020年11月13日

株式会社フジミインコーポレーテッド

市場概況

世界半導体市場動向（年次 実績/予測） 用途別

- ・2019年成長率は、スマホ、DC*、車、仮想通貨等の成長鈍化で、**-12.0%**（メモリ市場 **-32.6%**）
- ・2020年予測（2020年6月時点）では、コロナ感染症拡大の影響で先行きは依然不透明であるものの、在宅関連需要が下支えし、**+3.3%**の回復を見込む



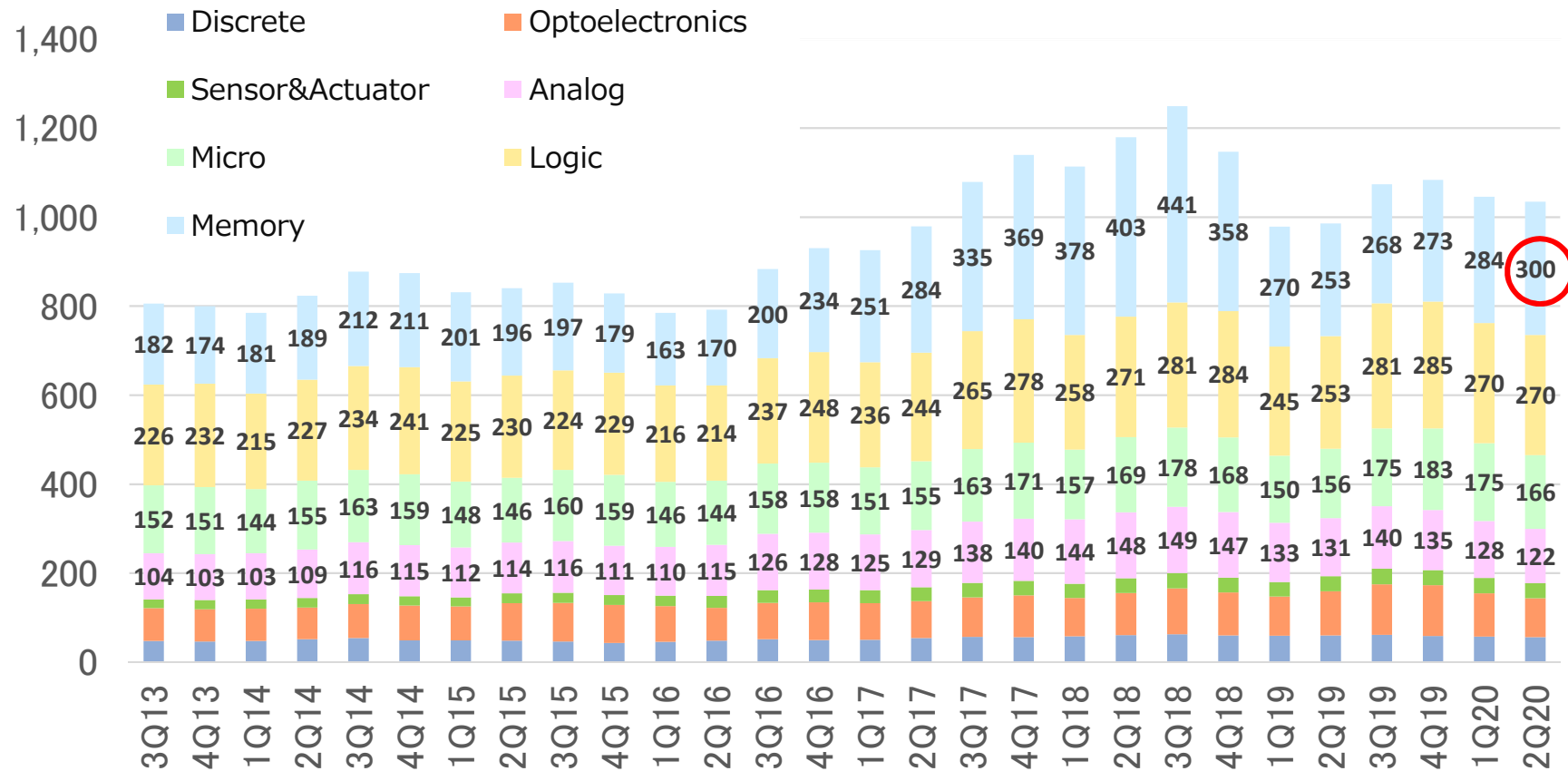
*DCとは、データセンターを示す。

出所：WSTS（2020/6/9）

世界半導体市場動向（四半期 実績） 用途別

・2020年4-6月期では、新型コロナウイルス（以下、コロナ）感染症拡大の影響による在宅関連需要の増加に伴い、データセンター及びPC向けを中心としたメモリ半導体が6四半期ぶりに300億ドルに回復

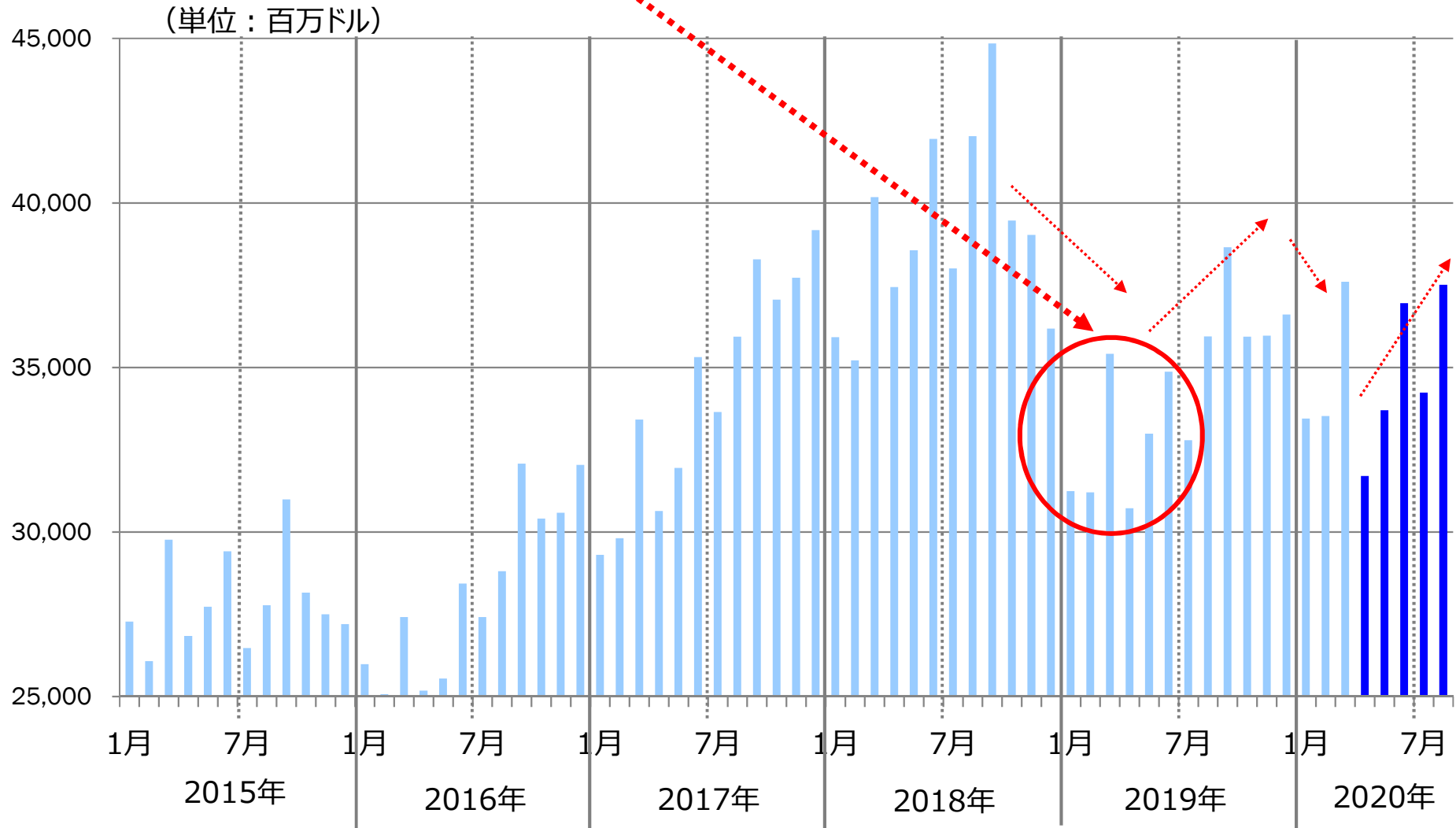
単位：億ドル



出所：WSTS

世界半導体市場動向（月次 実績 ※2020年8月まで）

・2019年1月から7月まで半年ほど低迷した後、北米、中国を中心に回復していたが、2020年1月より再び下降し、4月で底打ちし再び回復傾向

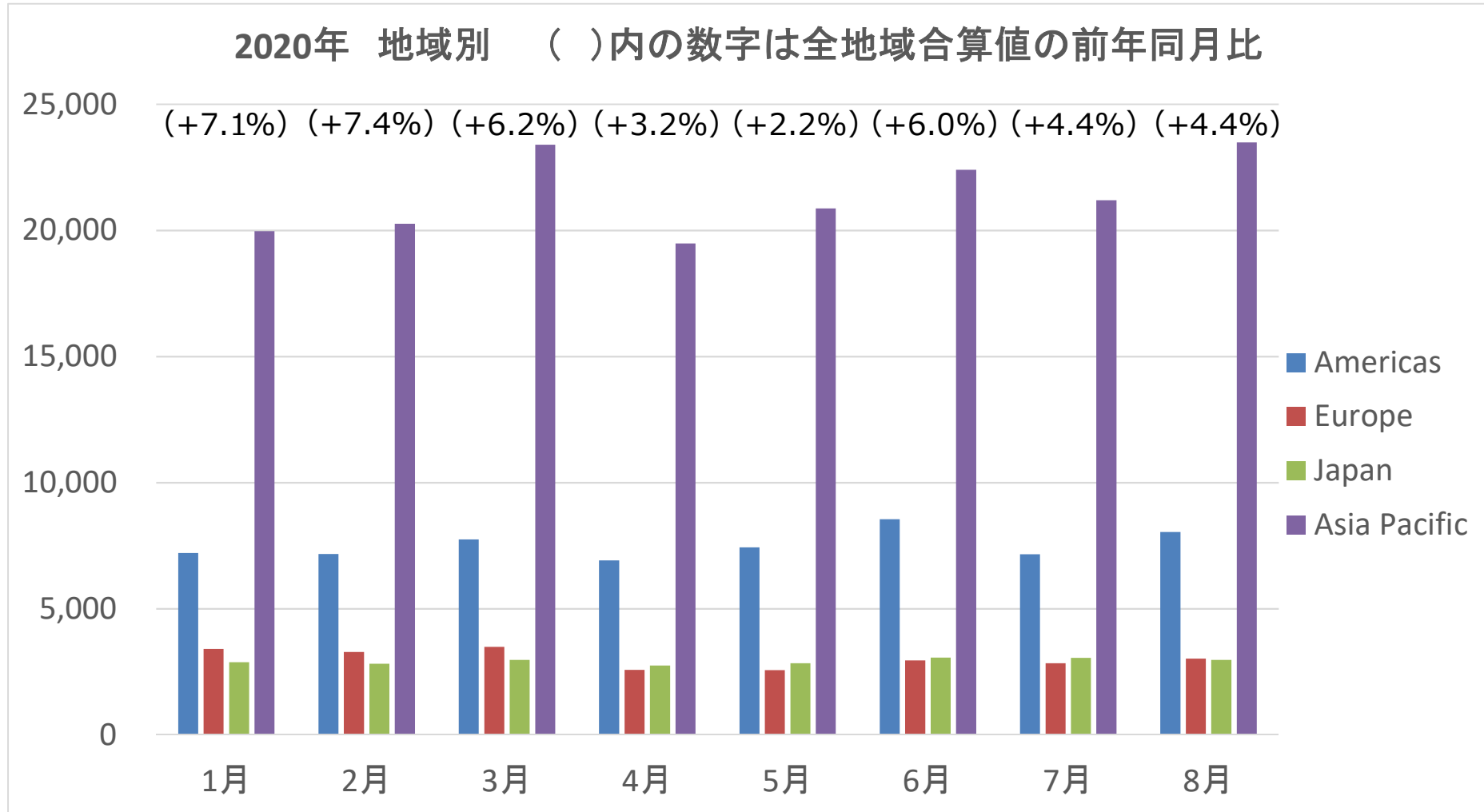


出所：WSTS（2020/10/1）

世界半導体市場動向 (地域別 月次 実績 ※2020年1月～8月まで)

・成長率は、2020年1月から3月まで前年同月比6～7%台であったが、4月5月は2～3%台まで鈍化するも、6月以降は回復傾向

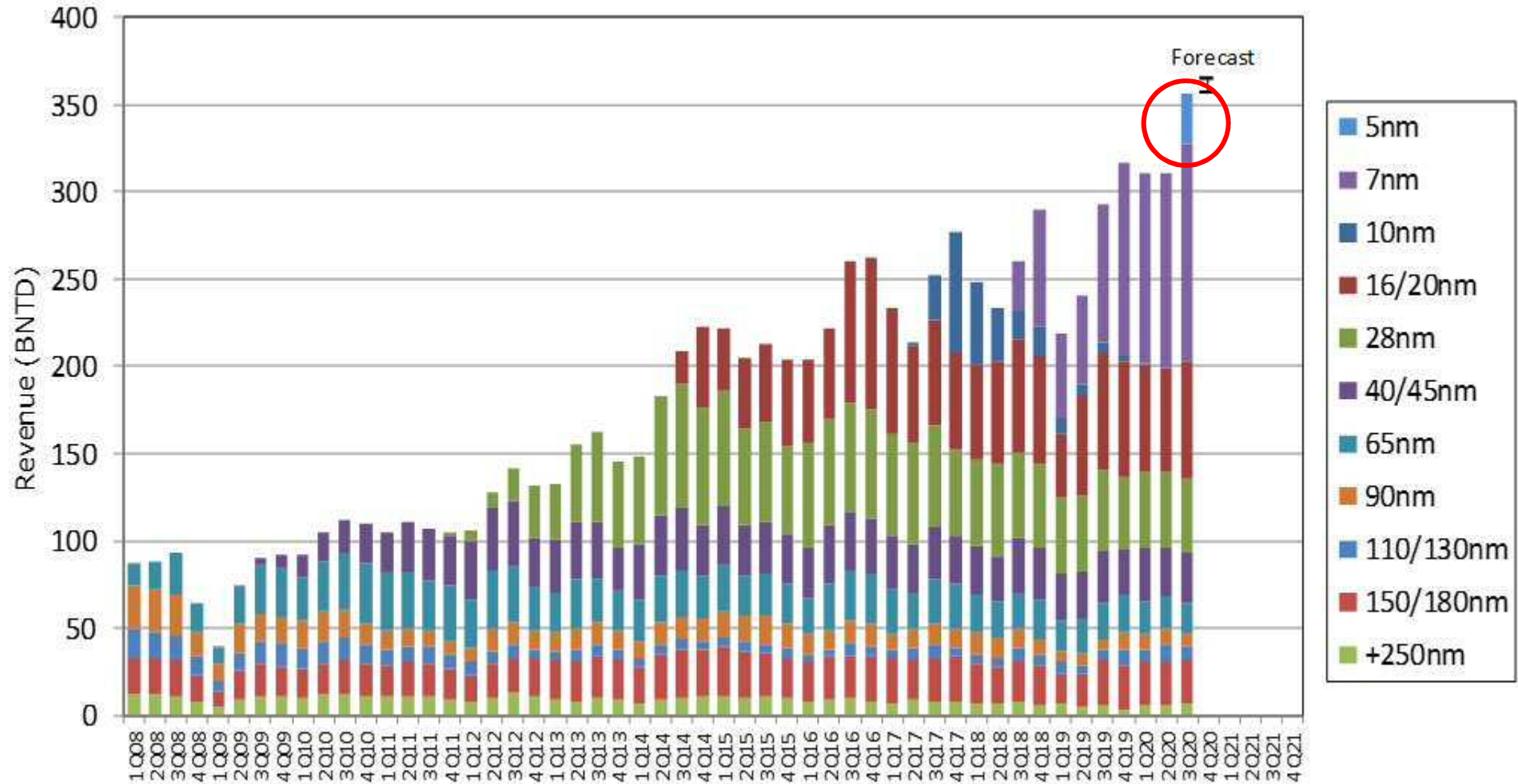
(単位：百万ドル)



出所：WSTS (2020/10/1)

台湾セミコンダクター（TSMC）売上高（2020年7-9月期）

- ・売上高は過去最高を更新
- ・Node別売上高では、7-9月期より5nm製品を売上高に計上開始
- ・全ての世代が好調な上に5nmの売上高が上乘せされた状況

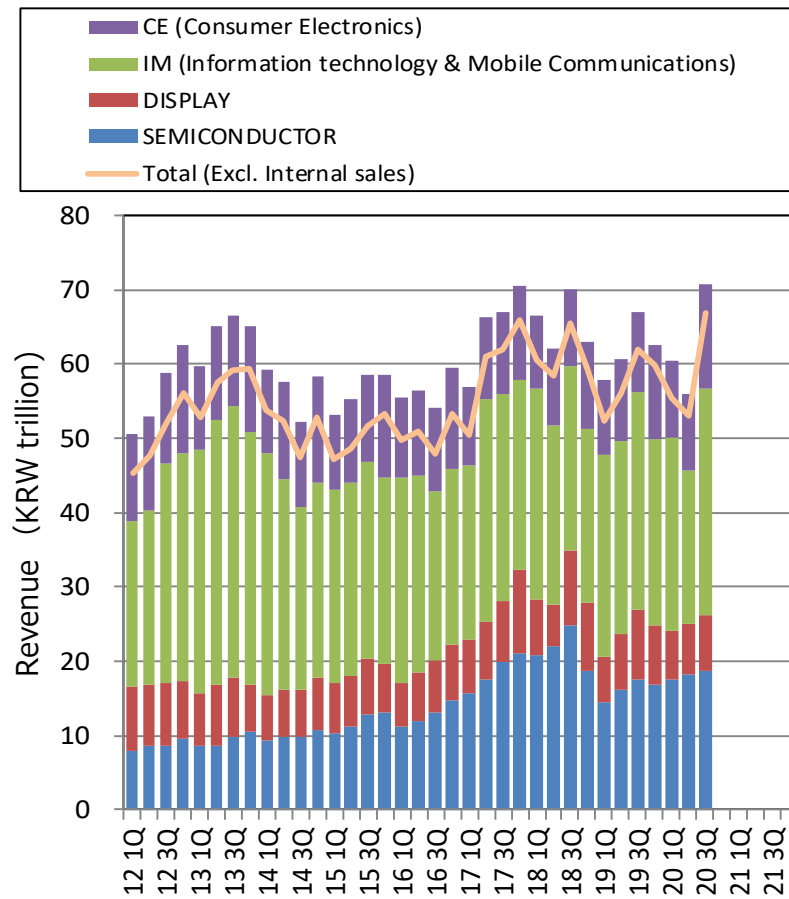


出所：TSMC公開情報よりフジミ作成

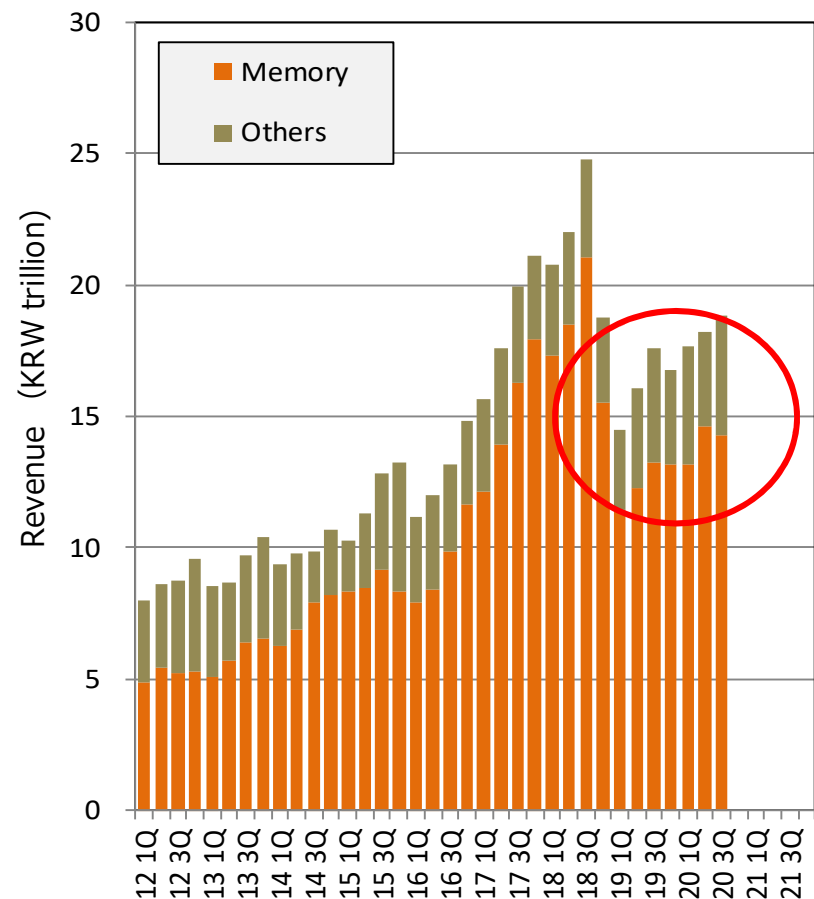
サムスン電子 売上高 (2020年7-9月期)

- ・半導体事業は、2019年1-3月期から売上増加が継続
- ・DRAMはPC、スマホ向けで好調
- ・NANDはゲーム機向けで好調

<サムスン電子 全社 売上高>



<サムスン電子 半導体事業 売上高>

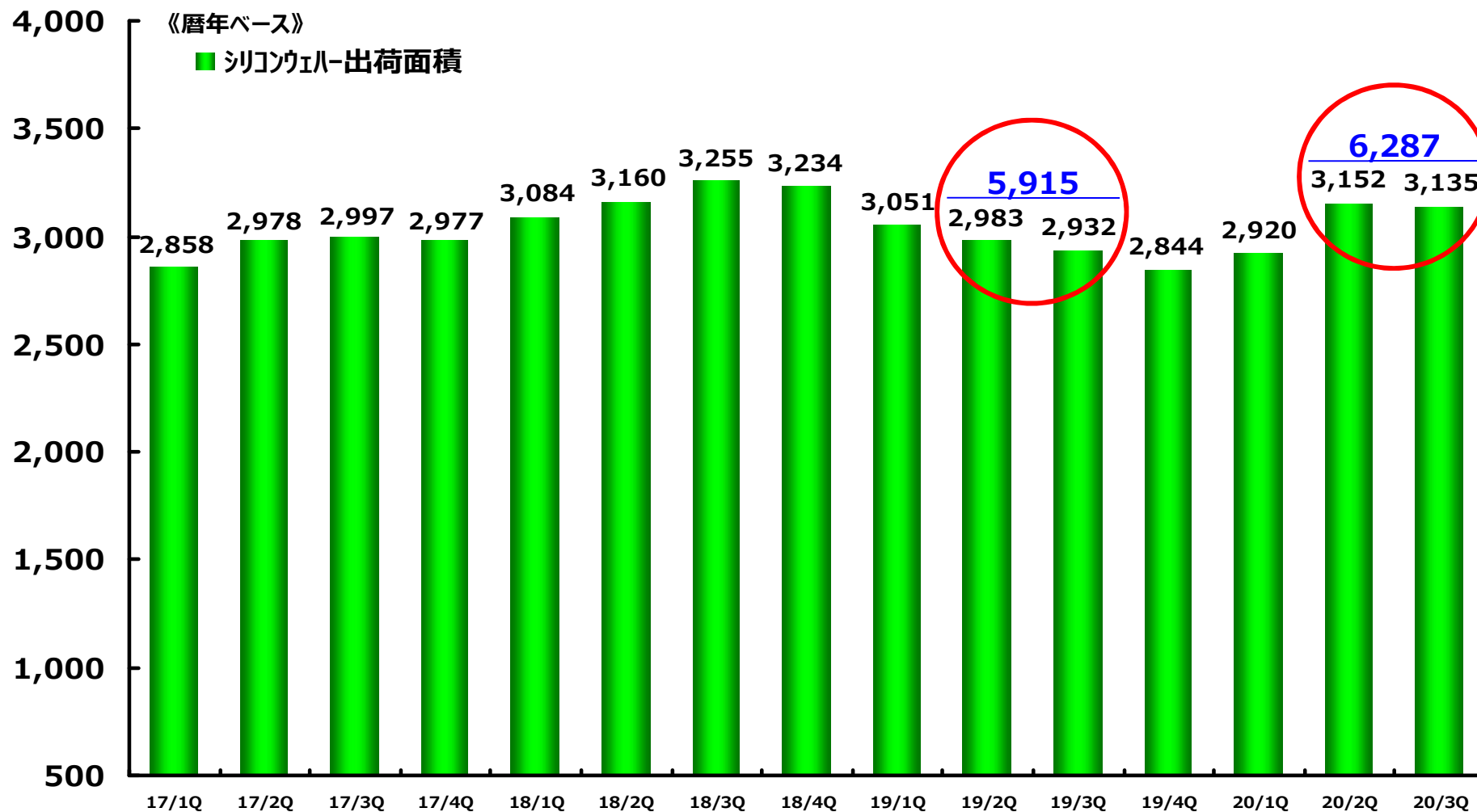


出所：サムスン電子公開情報よりフジミ作成

シリコンウェハ-出荷面積 (四半期)

・2020年4-9月期のシリコンウェハ-出荷面積は、前年同期比+6.2%

百万平方インチ



出所：SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

マクロ環境

- コロナ感染症拡大により在宅関連需要が増加
- コロナ感染症拡大及び米中貿易摩擦の激化によるサプライチェーン断絶のリスク上昇

半導体市場

- ロジック半導体 : サプライチェーン断絶リスクに備えた在庫積み増しの動きに伴い、スマホ向けを中心に最先端分野が高稼働
- メモリ半導体 : データセンター及びPC向けの在宅関連需要の増加及びサプライチェーン断絶リスクに備えた在庫積み増しの動きに伴い最先端分野が高稼働
- シリコンウェハー : 半導体需要の増加及びサプライチェーン断絶リスクに備えた在庫積み増しの動きに伴い、出荷面積は前年同期比6.2%増

非半導体市場

- 自動車、産業機械市場は上期に底を打ち、下期は回復が期待される

決算概要

2021年3月期第2四半期 決算サマリー

【2021年3月期 上期業績】

✓ 売上高	+8.2%*	: 最先端半導体デバイス向けCMP製品の販売が好調
✓ 営業利益	+29.9%	: 最先端半導体デバイス向け売上増加に加え、製品ミックスの良化
✓ 経常利益	+24.2%	:
✓ 当期純利益	+29.1%	: 営業利益・経常利益・当期純利益ともに過去最高を更新
✓ CMP向け	+18.5%	: 最先端半導体デバイス向け製品の販売増加
✓ シリコンウェハー向け	+5.1%	: 半導体需要増及び在庫積み増しの動きに伴い販売増加
✓ ハードディスク向け	△14.3%	: 顧客のプロセス変更に伴う使用量減等により販売減少
✓ 一般工業用向け (研磨材)	△2.4%	: 自動車及び産業機械向け需要低迷により販売減少
■ 上期業績の背景		
1. コロナ感染症拡大の影響でデータセンターやPC向けの在宅関連需要の増加により、最先端半導体市況が堅調に推移		
2. コロナ感染症拡大及び米中貿易摩擦の激化によるサプライチェーン断絶の懸念から在庫積み増しの動きが継続		

決算概要 (上期実績)

単位：百万円	20年3月期		21年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想('20/8)	上期実績	前年同期比	前年下期比	上期予想比('20/8)
売上高	18,884	19,523	20,000	20,427	+8.2%	+4.6%	+2.1%
営業利益	2,863	3,144	3,600	3,718	+29.9%	+18.3%	+3.3%
営業利益率	15.2%	16.1%	18.0%	18.2%	-	-	-
経常利益	2,974	3,202	3,650	3,694	+24.2%	+15.3%	+1.2%
経常利益率	15.8%	16.4%	18.3%	18.1%	-	-	-
四半期純利益	2,212	2,058	2,800	2,855	+29.1%	+38.7%	+2.0%
四半期純利益率	11.7%	10.5%	14.0%	14.0%	-	-	-

- ・前年同期比で増収、製品構成が良化し大幅増益
- ・上期業績の背景：
 - データセンター及びPC向けの在宅関連需要の増加により、ロジックデバイス、メモリデバイスともに最先端半導体市況は堅調に推移
 - コロナ感染症拡大や米中貿易摩擦の激化に対する懸念から在庫積み増しの動きが継続

業績予想（下期予想）

単位：百万円	20年3月期		21年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想	下期見直予想('20/11)	前年同期比	同年上期比	予想比
売上高	18,884	19,523	20,427		19,073	△2.3%	△6.6%	
営業利益	2,863	3,144	3,718		3,081	△2.0%	△17.1%	
営業利益率	15.2%	16.1%	18.2%		16.2%	-	-	
経常利益	2,974	3,202	3,694	-	3,155	△1.5%	△14.6%	-
経常利益率	15.8%	16.4%	18.1%		16.5%	-	-	
四半期純利益	2,212	2,058	2,855		2,344	+13.9%	△17.9%	
四半期純利益率	11.7%	10.5%	14.0%		12.3%	-	-	

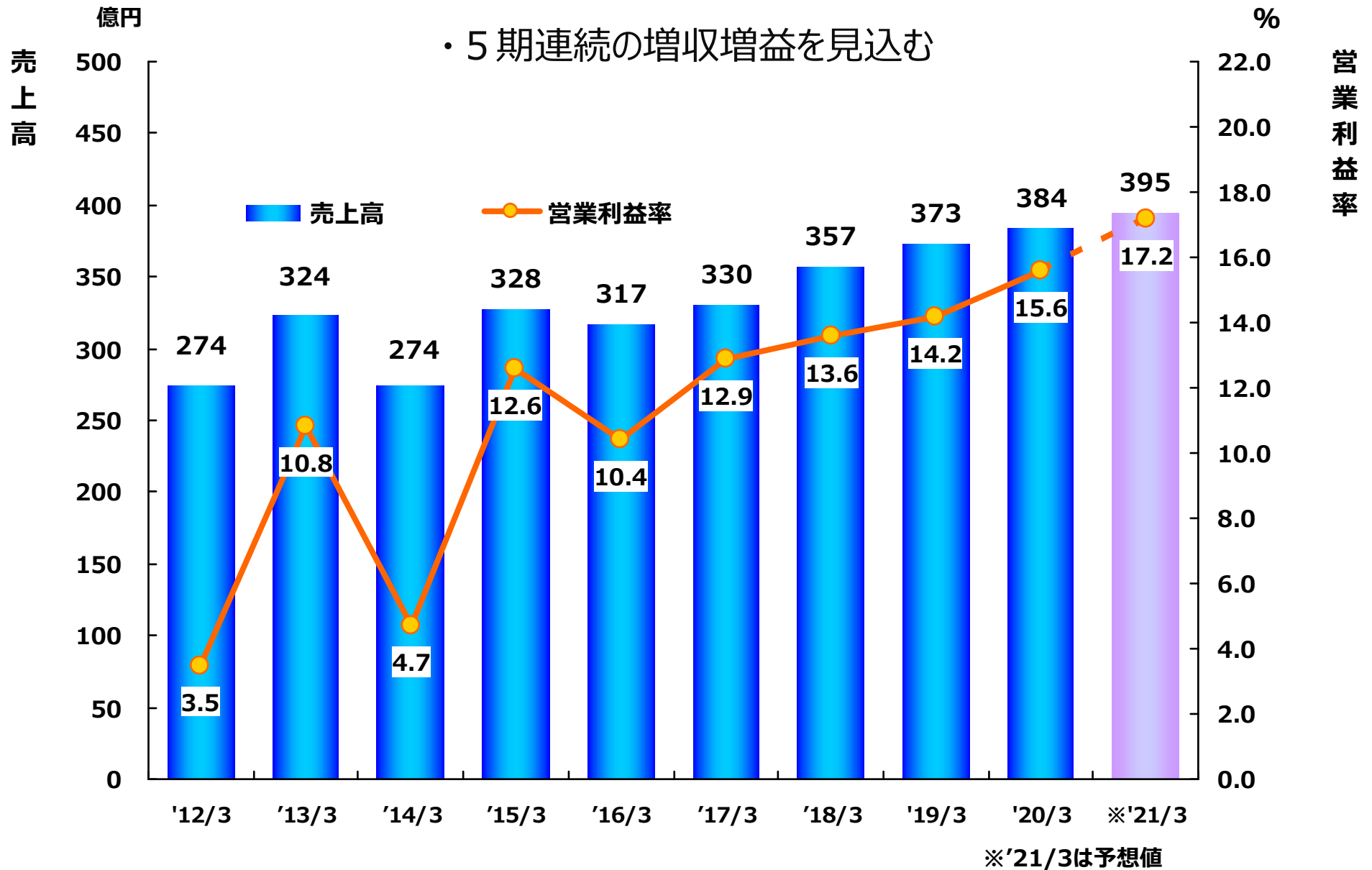
- 下期予想は上期実績を下回る
- 下期予想の背景：
 - コロナ感染症拡大及び米中貿易摩擦の動向が当社業績に及ぼす影響は引き続き不透明であること
 - 上期ほどの業績押し上げ要因（在宅関連需要の増加、在庫の積み増し）は期待できないこと
 - 上期に積み増された在庫に関しては、その調整または反動の動きが起こる可能性があること
- 為替（実績：106円／ドルに対し、下期見直予想：105円／ドル）

業績予想 (通期予想)

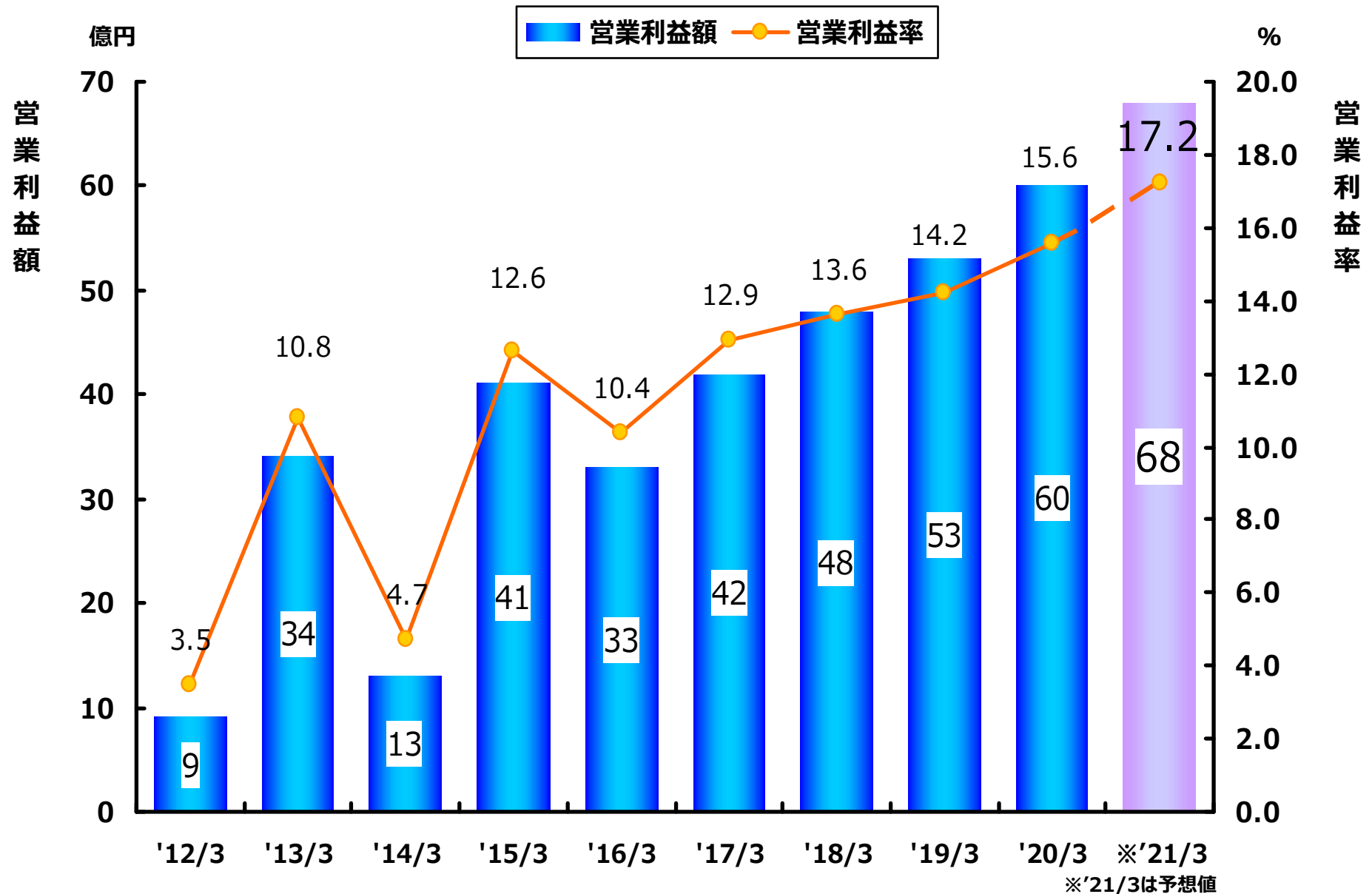
単位：百万円	20年3月期	21年3月期			
	通期実績	期初予想	修正予想 (’20/11)	前期比	期初予想比
売上高	38,408	-	39,500	+2.8%	-
営業利益	6,007		6,800	+13.2%	
営業利益率	15.6%		17.2%	-	
経常利益	6,177		6,850	+10.9%	
経常利益率	16.1%		17.3%	-	
当期純利益	4,270		5,200	+21.8%	
当期純利益率	11.1%		13.2%	-	

・増収増益予想（営業利益、経常利益、当期純利益では、過去最高の更新を見込む）

業績推移 (通期)



営業利益 (通期)



用途別売上高

用途別売上高 (上期実績)

単位：百万円		20年3月期		上期 予想 ※	21年3月期			期初予想比
		上期 実績	下期 実績		上期 実績	前年 同期比	前年 下期比	
シリコンウェハ	ラッピング	1,834	2,004	-	2,158	+17.7%	+7.7%	-
	ポリシング	4,487	4,519		4,521	+0.8%	+0.0%	
	切断	137	136		109	△20.4%	△19.9%	
	計	6,458	6,660		6,788	+5.1%	+1.9%	
CMP		8,483	8,878		10,055	+18.5%	+13.3%	
ディスク	アルミディスク	983	978		927	△5.7%	△5.2%	
	ガラスディスク	111	92		11	△89.7%	△87.6%	
	計	1,094	1,070		938	△14.2%	△12.4%	
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	1,740	1,831		1,699	△2.3%	△7.2%	
	一般工業用(非研磨材)	949	963		921	△3.0%	△4.4%	
	計	2,689	2,794		2,620	△2.6%	△6.2%	
製品売上高		18,724	19,404	20,401	+9.0%	+5.1%		
商品売上高		160	119	26	△83.8%	△78.2%		
売上高 合計		18,884	19,524	20,427	+8.2%	+4.6%		

※上期予想は非開示

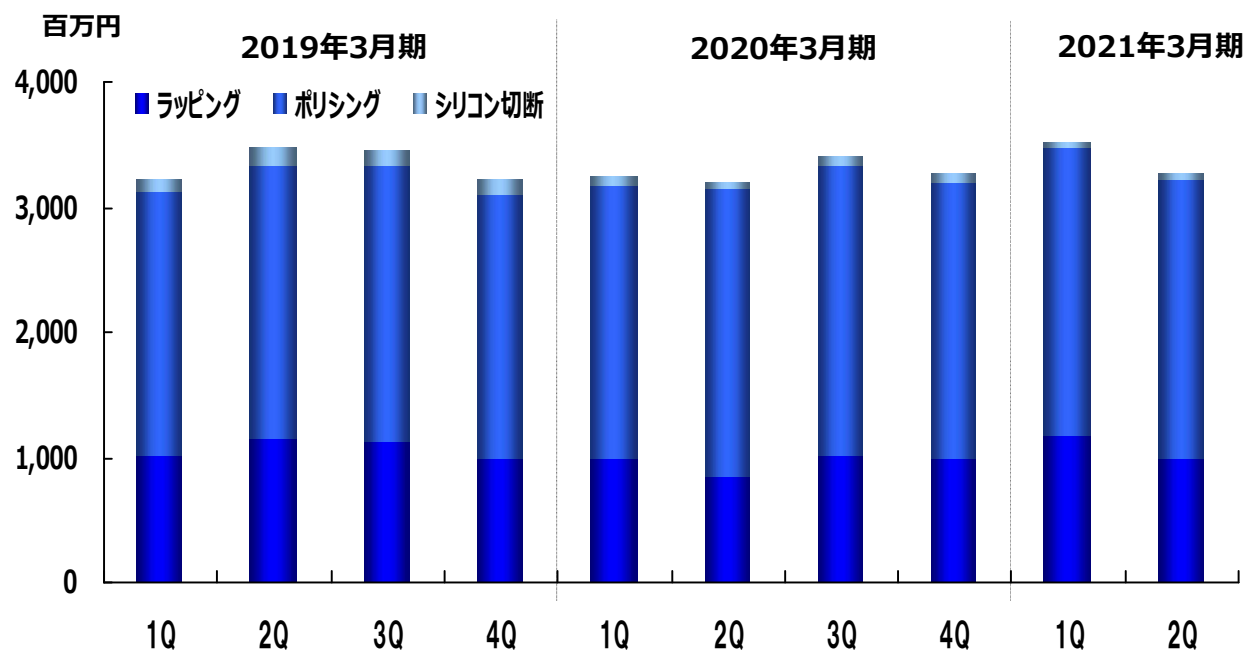
シリコンウェハー売上高（上期実績）

「上期」

単位：百万円

		20年3月期		21年3月期				
		上期実績	下期実績	上期※ 予想	上期実績	前年 同期比	前年 下期比	期初予想比
シリコンウェハー	ラッピング	1,834	2,004	-	2,158	+17.7%	+7.7%	-
	ポリシング	4,487	4,519		4,521	+0.8%	+0.0%	
	切断	137	136		109	△20.4%	△19.9%	
	計	6,458	6,660		6,788	+5.1%	+1.9%	

※上期予想は非開示



- ・事業環境：
 - 在宅関連需要の増加によりシリコンウェハー市場は堅調
 - サプライチェーンの断絶リスクによりシリコンウェハー在庫積み増しの動きあり
- ・ラッピング向け製品：
 - 上記要因に加え、前期上期に一部顧客で在庫調整があったことから大幅増収
- ・ポリシング向け製品：
 - 上記要因があったものの、前年上期に一部顧客で当社製品の在庫積み増しがあったことから前年同期並み

シリコンウェハー売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

		20年3月期		21年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想	下期修正予想('20/11)	前年同期比	上期比	期初予想比
シリコンウェハー	ラッピング	1,834	2,004	2,158	-	2,042	+1.9%	△5.4%	-
	ポリシング	4,487	4,519	4,521		4,579	+1.3%	+1.3%	
	切断	137	136	109		91	△33.2%	△16.5%	
	計	6,458	6,660	6,788		6,712	+0.8%	△1.1%	

「通期」

単位：百万円

		19年3月期	20年3月期	21年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想	通期修正予想('20/11)	前期比	期初予想比
シリコンウェハー	ラッピング	4,297	3,838	-	4,200	+9.4%	-
	ポリシング	8,621	9,006		9,100	+1.0%	
	切断	453	273		200	△26.8%	
	計	13,373	13,118		13,500	+2.9%	

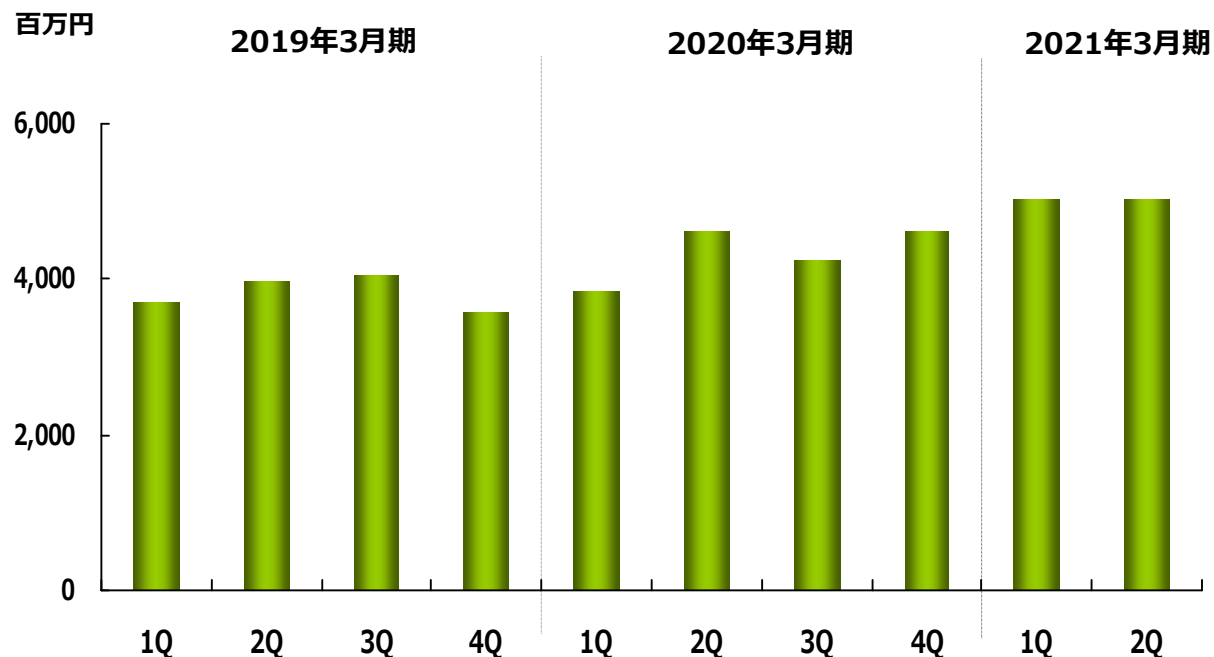
CMP売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

	20年3月期		21年3月期				
	上期実績	下期実績	上期予想※	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
CMP	8,483	8,878	-	10,055	+18.5%	+13.3%	-

※上期予想は非開示



- ・事業環境：
 - データセンター及びPC向け需要の増加に伴い、半導体業界は高稼働
 - サプライチェーンの断絶リスクにより、最先端半導体デバイスを中心に在庫積み増しの動きあり
- ・CMP向け製品：
 - ロジック、メモリともに最先端半導体デバイス向け製品の販売増加により増収

CMP売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

	20年3月期		21年3月期					
	上期実績	下期実績	上期実績	下期予想	下期修正予想('20/11)	前年同期比	上期比	期初予想比
CMP	8,483	8,878	10,055	-	8,645	△2.6%	△14.0%	-

「通期」

単位：百万円

	19年3月期	20年3月期	21年3月期			
	通期実績	通期実績	通期予想	通期修正予想('20/11)	前期比	期初予想比
CMP	15,305	17,361	-	18,700	+7.7%	-

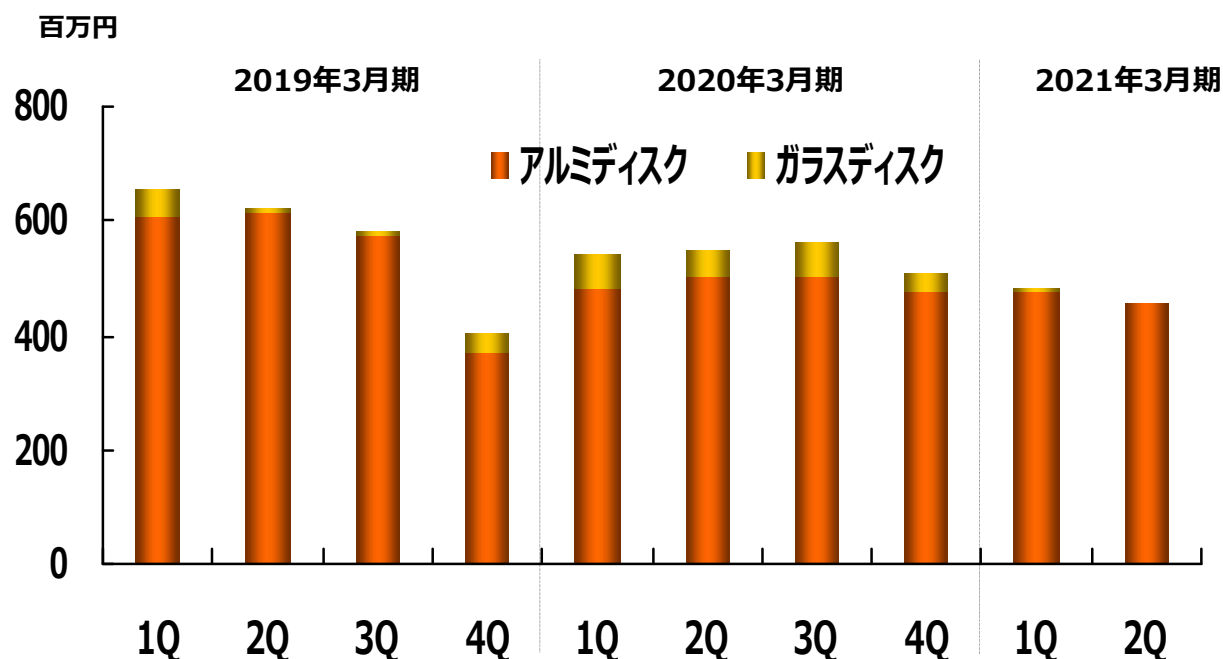
ディスク売上高（上期実績）

「上期」

単位：百万円

		20年3月期		21年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想※	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
ディスク	アルミディスク	983	978	-	927	△5.7%	△5.2%	-
	ガラスディスク	111	92		11	△89.7%	△87.6%	
	計	1,094	1,070		938	△14.2%	△12.4%	

※上期予想は非開示



・事業環境
 市場縮小（SSDへの移行）

・アルミディスク向け製品：
 上記要因により減収

・ガラスディスク向け製品：
 顧客のプロセス変更により減収
 （その結果、製品構成は良化）

ディスク売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

		20年3月期		21年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想	下期修正予想('20/11)	前年同期比	上期比	期初予想比
ディスク	アルミディスク	983	978	927	-	923	△5.7%	△0.4%	-
	ガラスディスク	111	92	11		39	△57.7%	+241.9%	
	計	1,094	1,070	938		962	△10.2%	+2.5%	

「通期」

単位：百万円

		19年3月期	20年3月期	21年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想	通期修正予想('20/11)	前期比	期初予想比
ディスク	アルミディスク	2,171	1,961	-	1,850	△5.7%	-
	ガラスディスク	96	203		50	△75.2%	
	計	2,268	2,164		1,900	△12.2%	

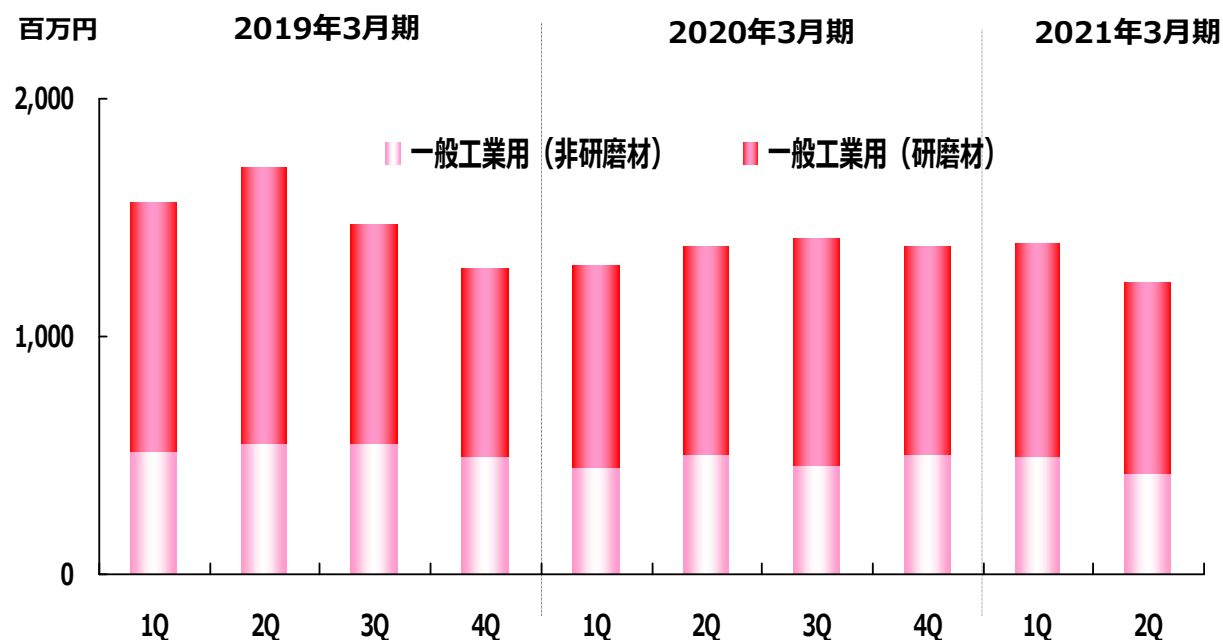
機能材・溶射材売上高（上期実績）

《上期》

単位：百万円

		20年3月期		21年3月期				
		上期実績	下期実績	上期予想 [※]	上期実績	前年同期比	前年下期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	1,740	1,831	-	1,699	△2.3%	△7.2%	-
	一般工業用(非研磨材)	949	963		921	△3.0%	△4.4%	
	計	2,689	2,794		2,620	△2.6%	△6.2%	

※上期予想は非開示



・事業環境
 コロナ感染症拡大により、自動車及び産業機械市況は低迷

・一般工業用（研磨材）：
 上記要因により減収

・一般工業用（非研磨材）：
 溶射材は前年同期並みに推移したものの、触媒担体及び絶縁材料の需要減少により減収

機能材・溶射材売上高（下期予想・通期予想）

「下期」

単位：百万円

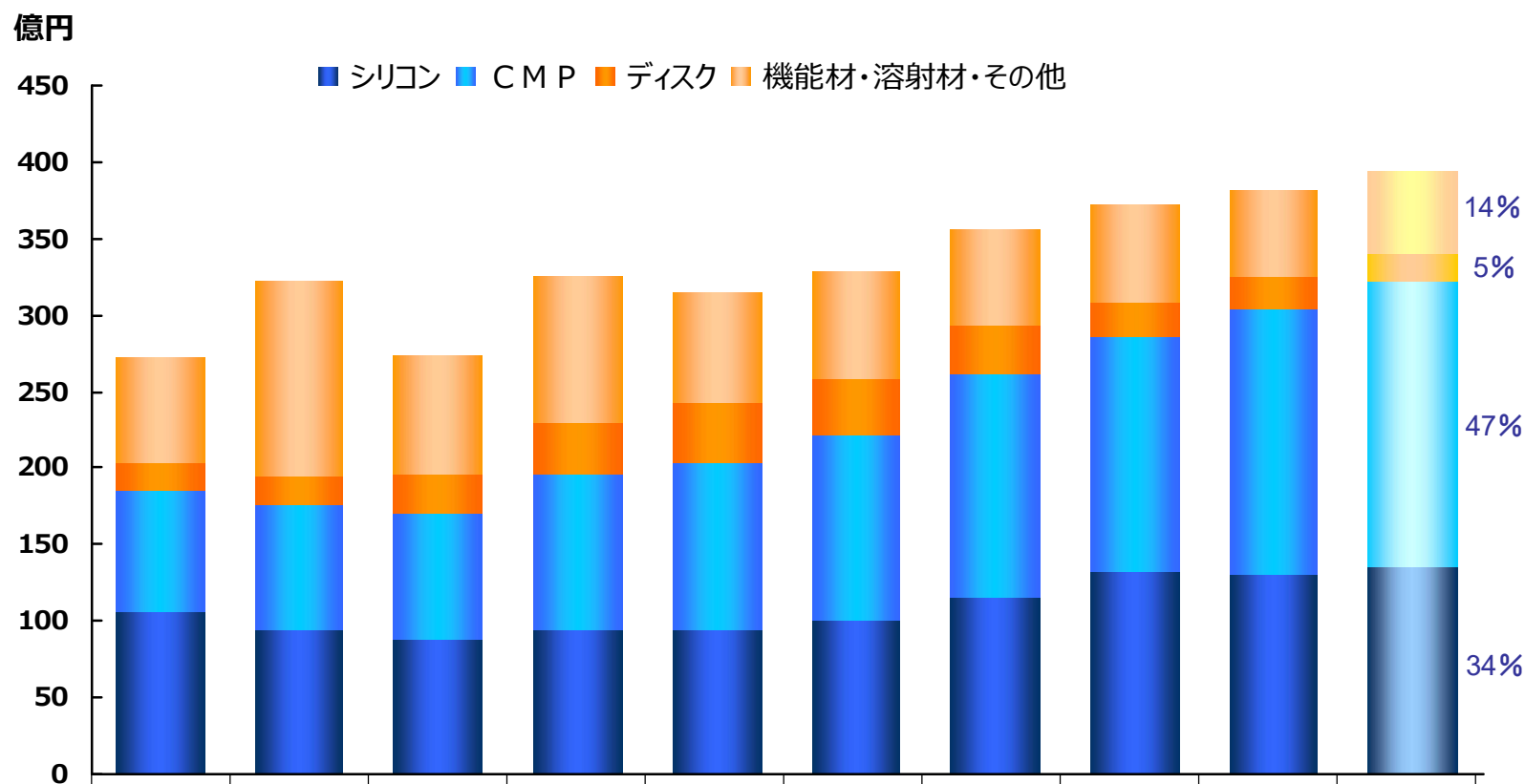
		20年3月期		21年3月期					
		上期実績	下期実績	上期実績	下期予想	下期修正予想('20/11)	前年同期比	上期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	1,740	1,831	1,699	-	1,701	△7.1%	+0.1%	-
	一般工業用(非研磨材)	949	963	921		979	+1.7%	+6.3%	
	計	2,689	2,794	2,620		2,680	△4.1%	+2.3%	

「通期」

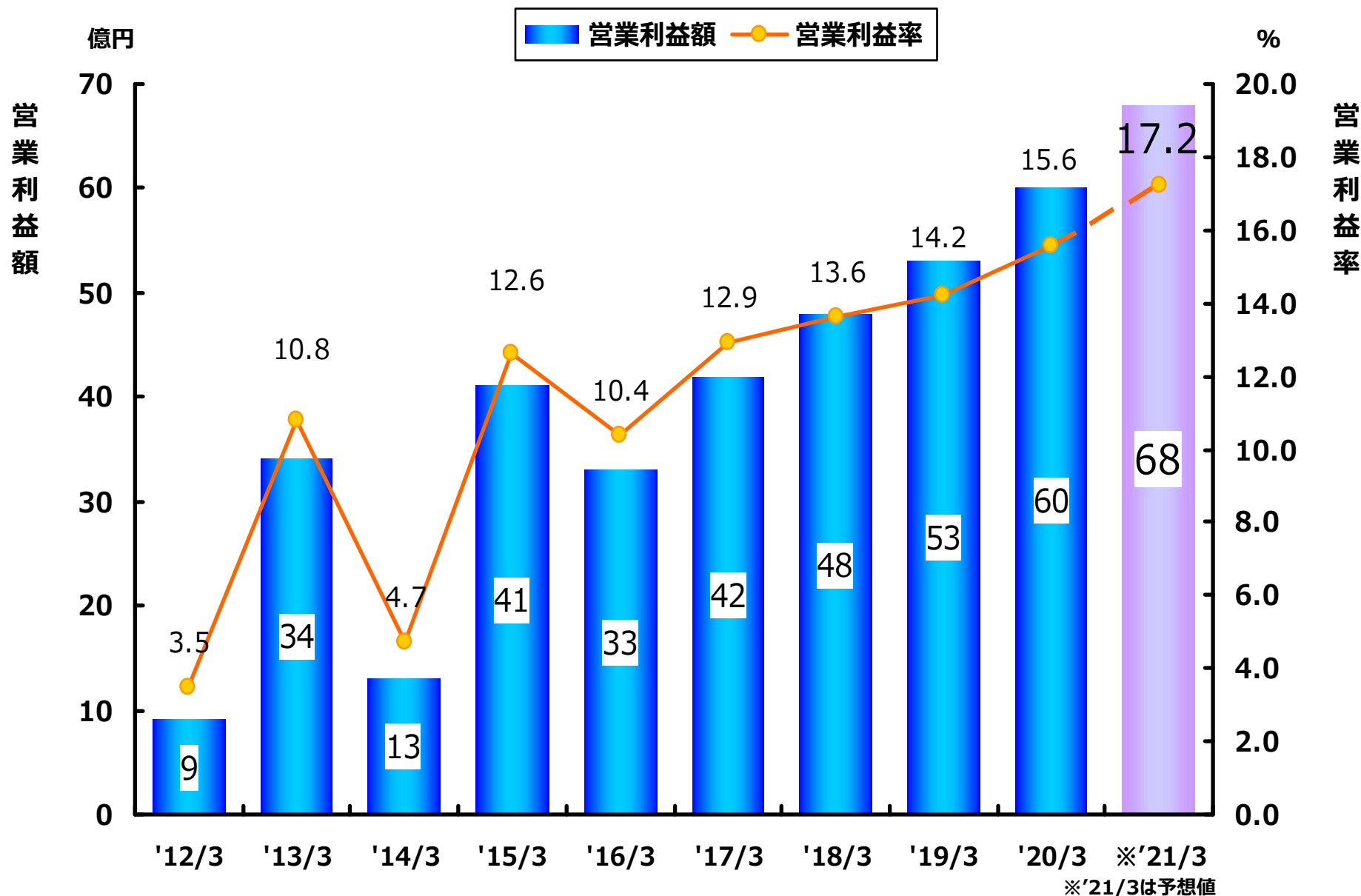
単位：百万円

		19年3月期	20年3月期	21年3月期			
		通期実績	通期実績	通期予想	通期修正予想('20/11)	前期比	期初予想比
機能材・溶射材	一般工業用(研磨材)	3,931	3,571	-	3,400	△4.8%	-
	一般工業用(非研磨材)	2,121	1,912		1,900	△0.6%	
	計	6,053	5,483		5,300	△3.3%	

用途別売上高 (通期)



営業利益 (通期)

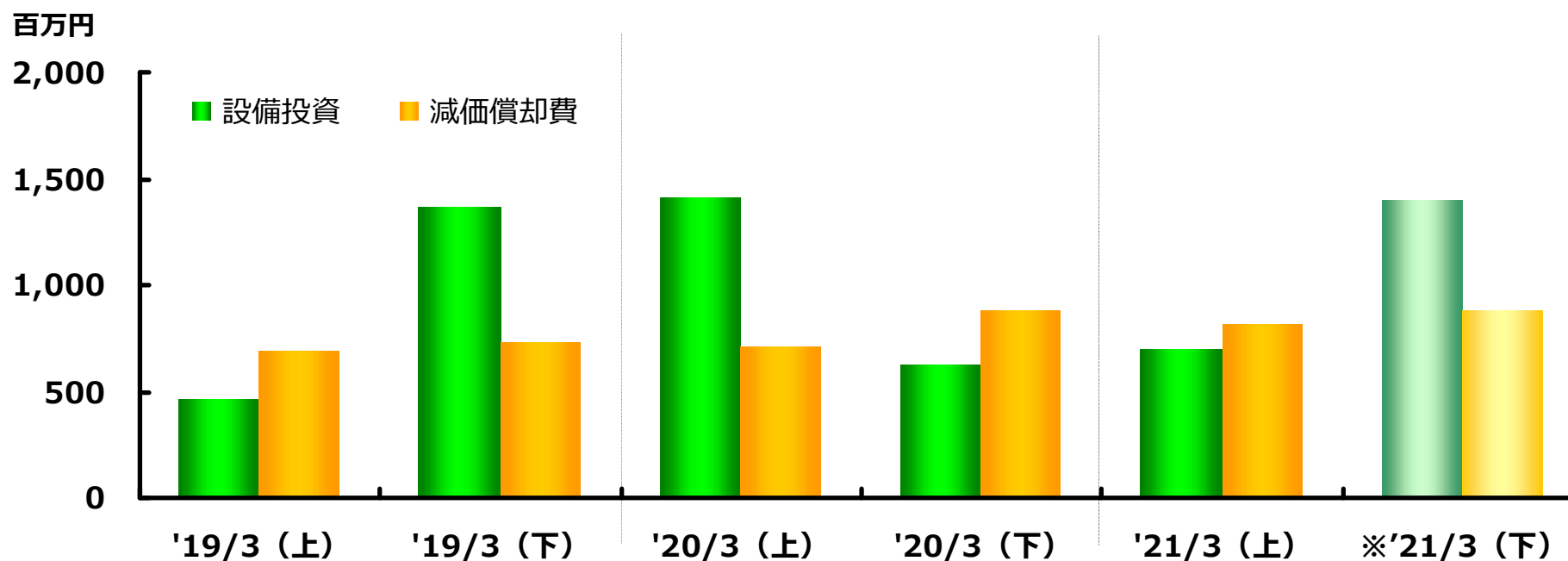


設備投資額
減価償却費
研究開発費

設備投資額・減価償却費（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	20年3月期		21年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画	上期実績	前年同期比	前年下期比	計画比	下期計画	下期修正計画('20/11)	前年同期比	同年上期比	計画比
設備投資額	1,409	621	-	704	△50.0%	+13.4%	-	-	1,396	+124.8%	+98.3%	-
減価償却費	715	883	-	815	+14.0%	△7.7%	-	-	885	+0.2%	+8.6%	-

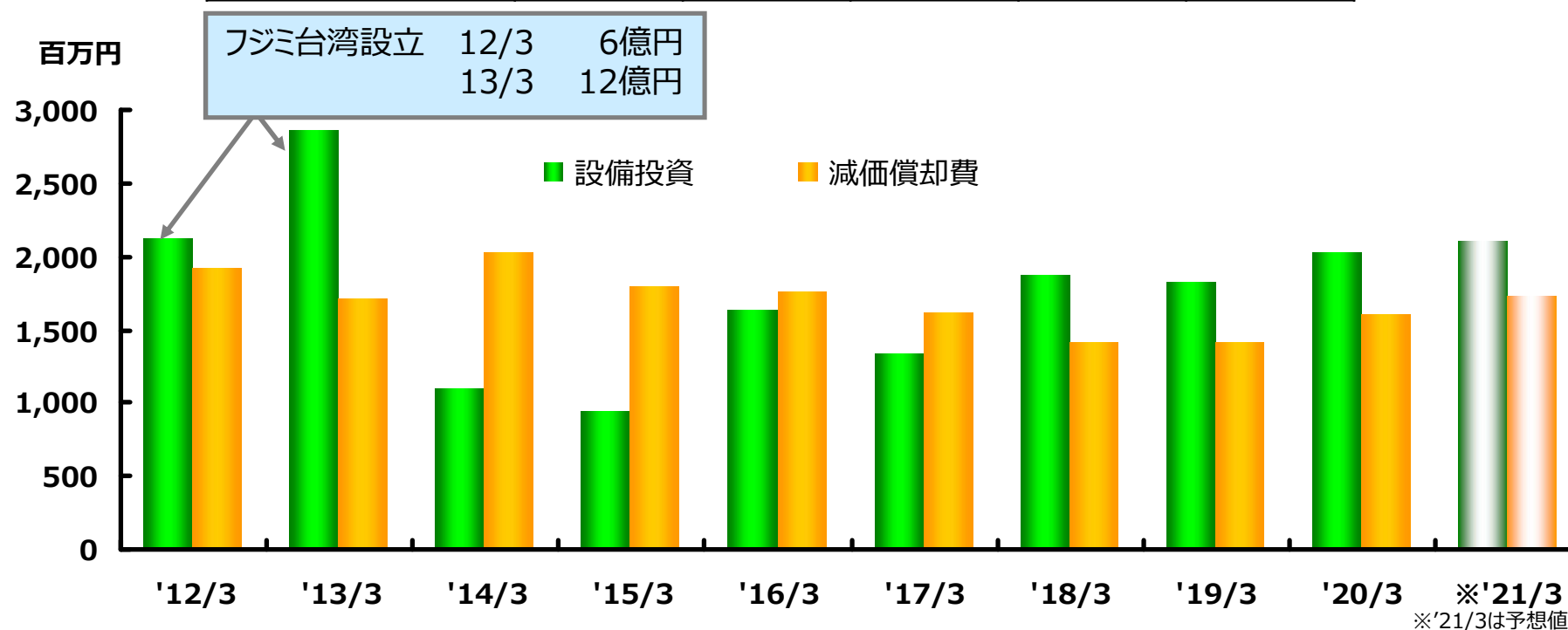


※'21/3 (下) は予想値

設備投資額・減価償却費（通期実績・通期計画）

単位：百万円

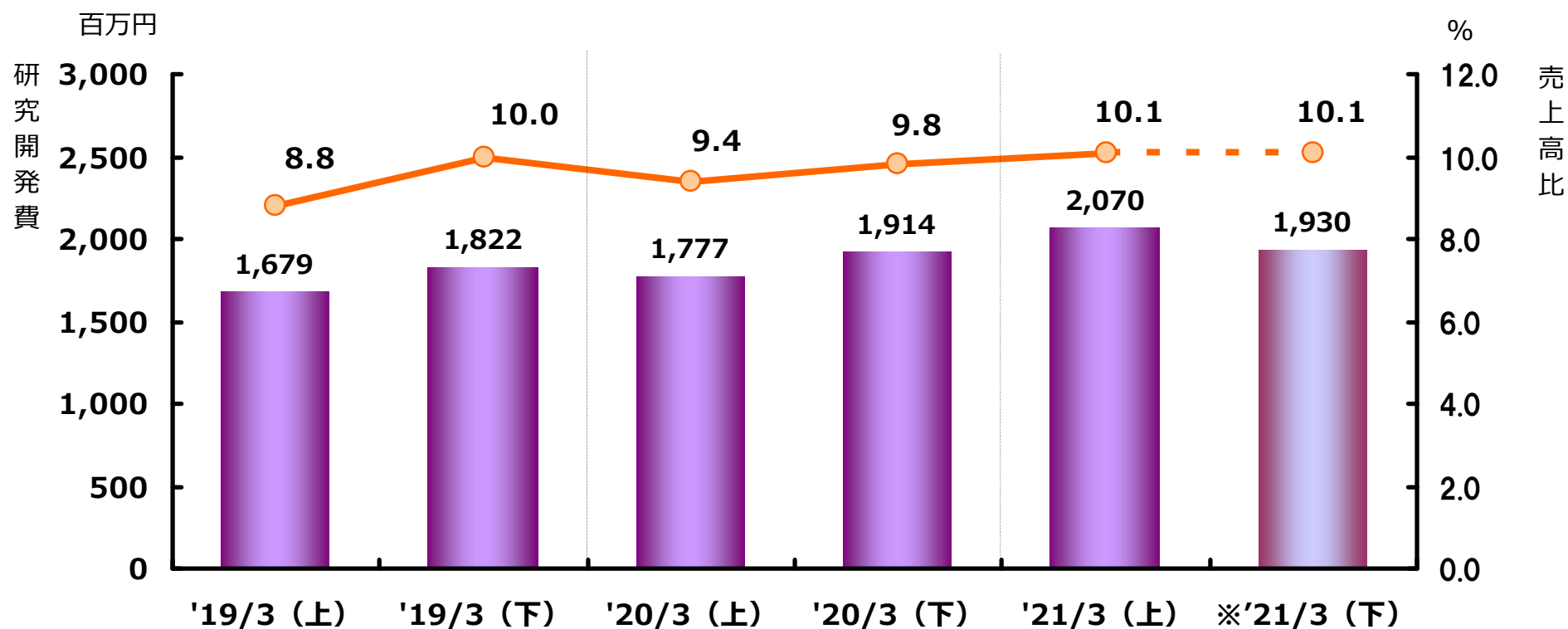
	20年3月期	21年3月期			
	通期実績	通期計画	通期修正計画('20/11)	前期比	期初計画比
設備投資	2,030	-	2,100	+3.4%	-
減価償却費	1,598	-	1,700	+6.4%	-



研究開発費／売上高比（上期実績・下期計画）

単位：百万円

	20年3月期		21年3月期									
	上期実績	下期実績	上期計画	上期実績	20年3月期			下期計画	下期修正計画 ('20/11)	21年3月期		
					前年同期比	前年下期比	計画比			前年同期比	同年前期比	計画比
研究開発費	1,777	1,914	-	2,070	+16.5%	+8.2%	-	-	1,930	+0.8%	△6.8%	-

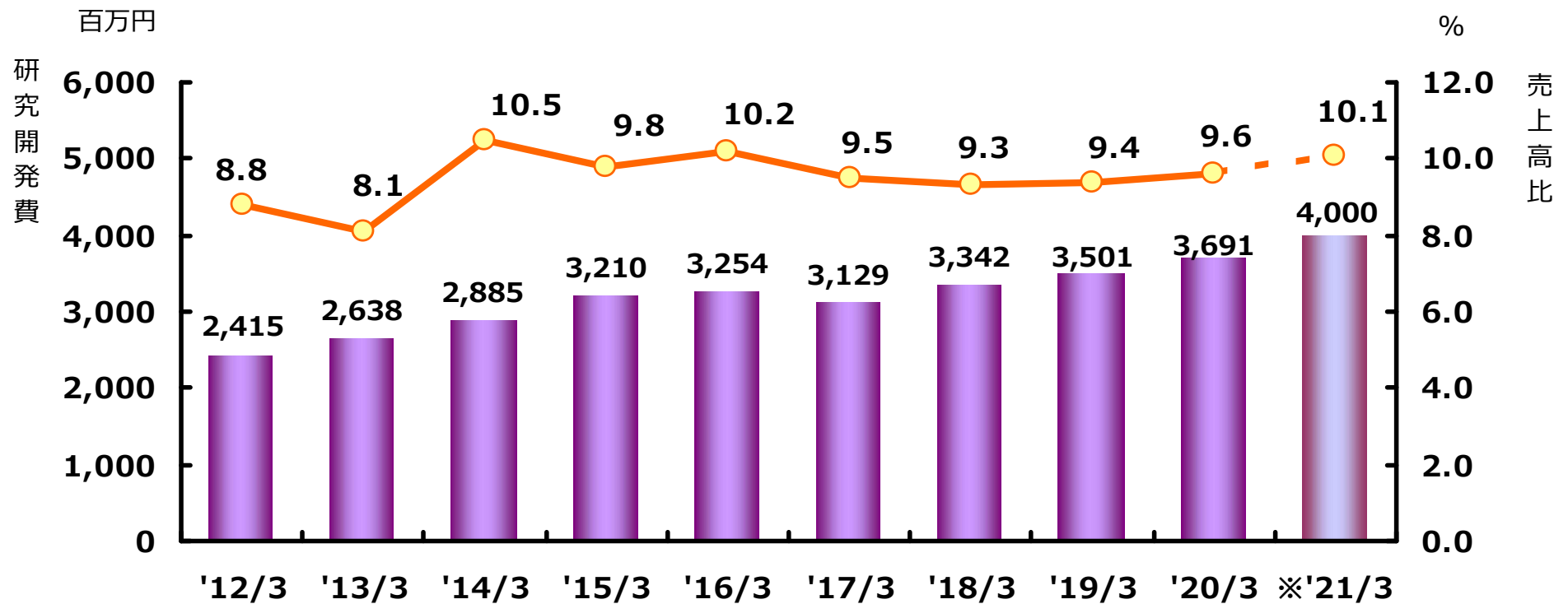


※'21/3 (下) は予想値

研究開発費／売上高比（通期実績・通期計画）

単位：百万円

	20年3月期	21年3月期		
	通期実績	通期計画	通期修正計画('20/11)	前期比
研究開発費	3,691	-	4,000	+8.4%



※'21/3は予想値

損益分析

営業利益増減要因

20/3期上期実績 → 21/3期上期実績

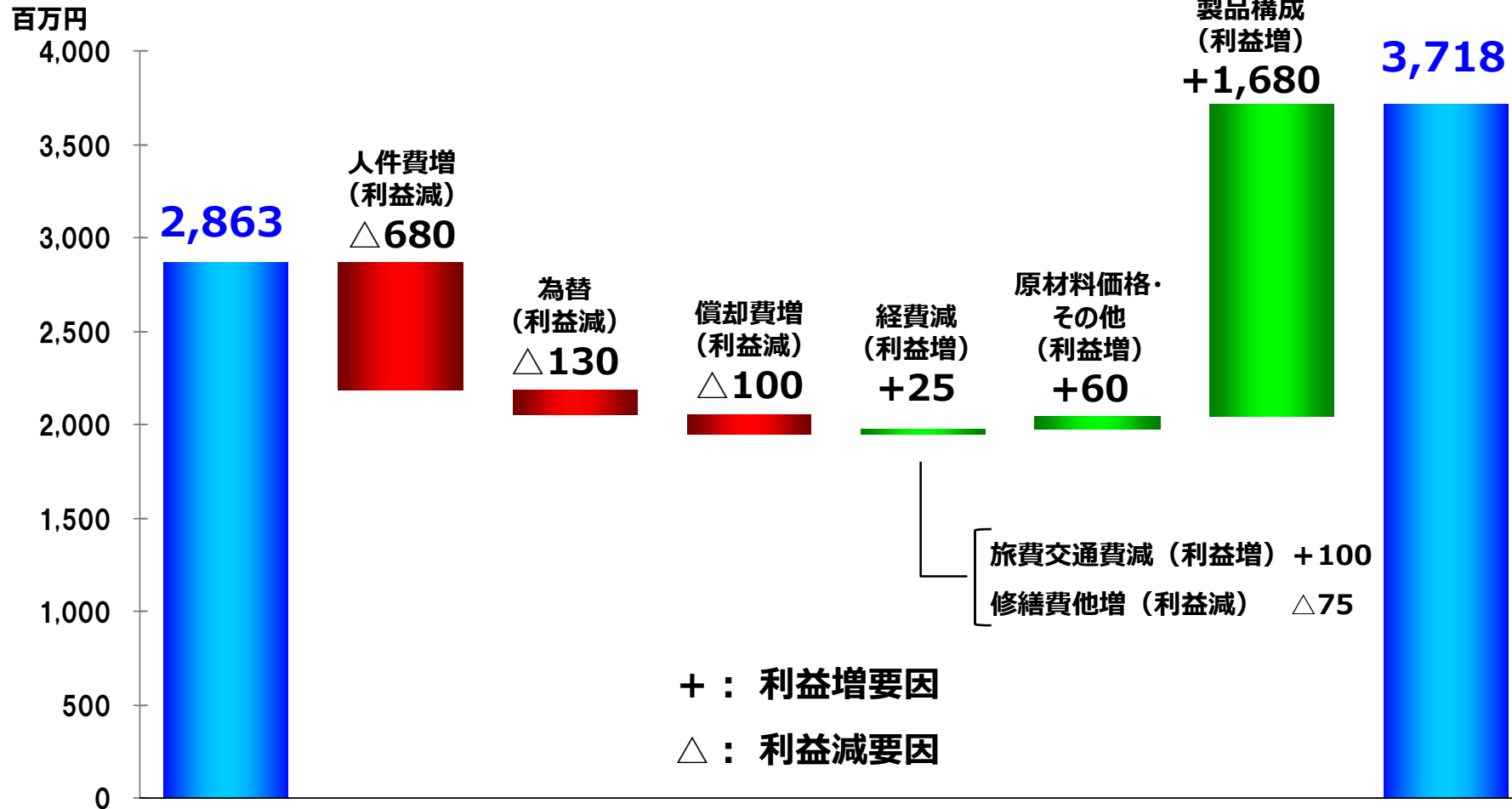
売上高 189億円

204億円

20/3期
上期実績

(売上増) +1,543百万円
(利益増) +855

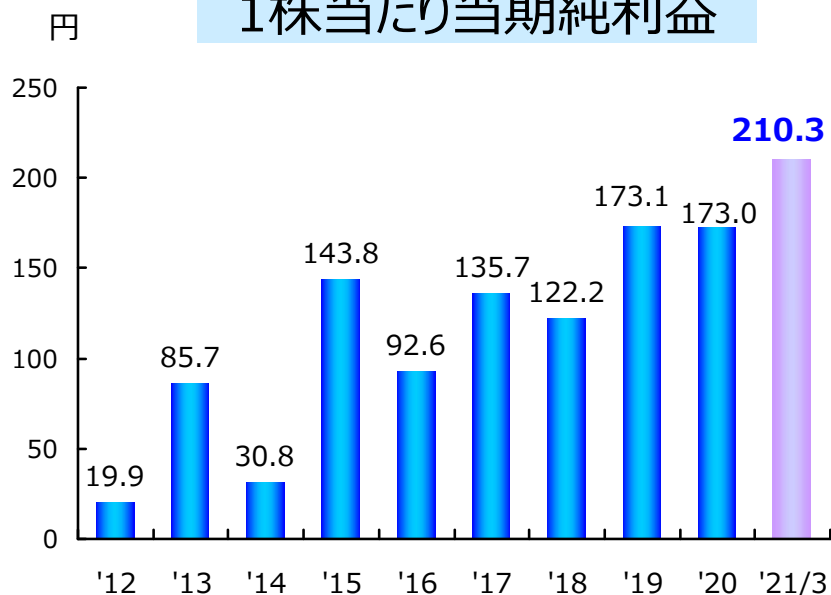
21/3期
上期実績



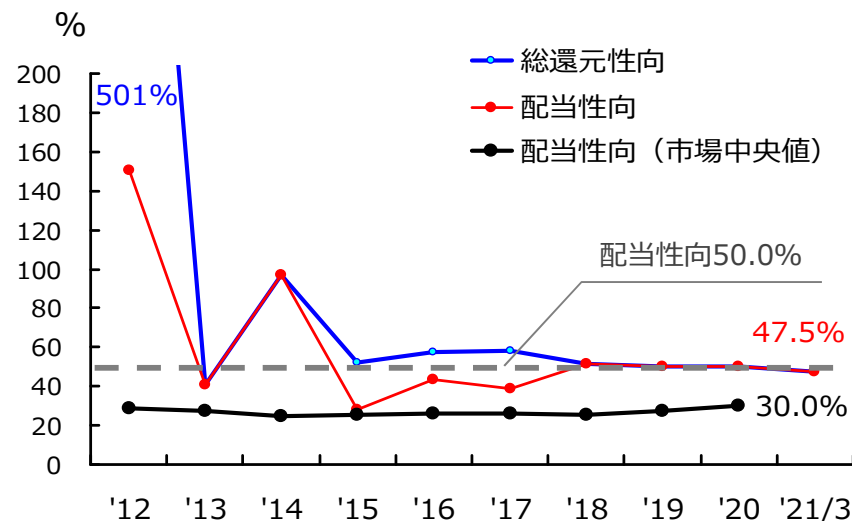
株主還元

積極的な株主還元と安定配当の継続

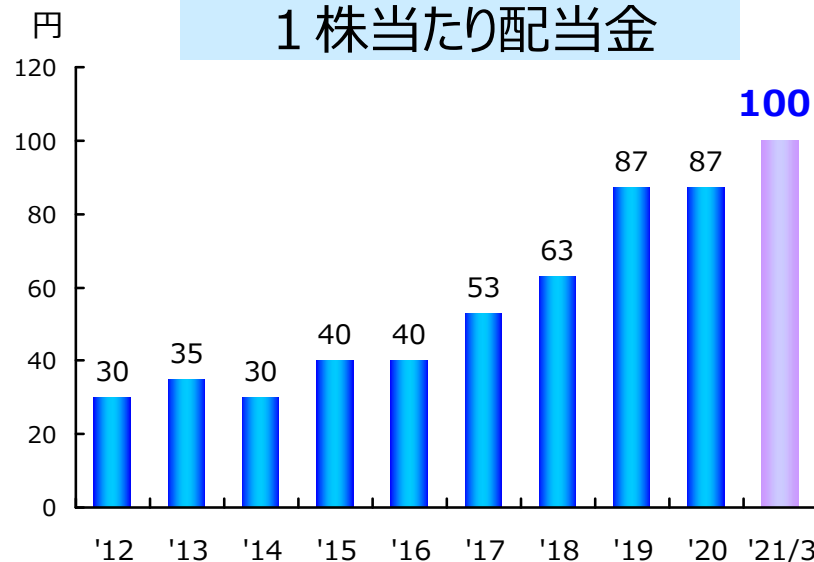
1株当たり当期純利益



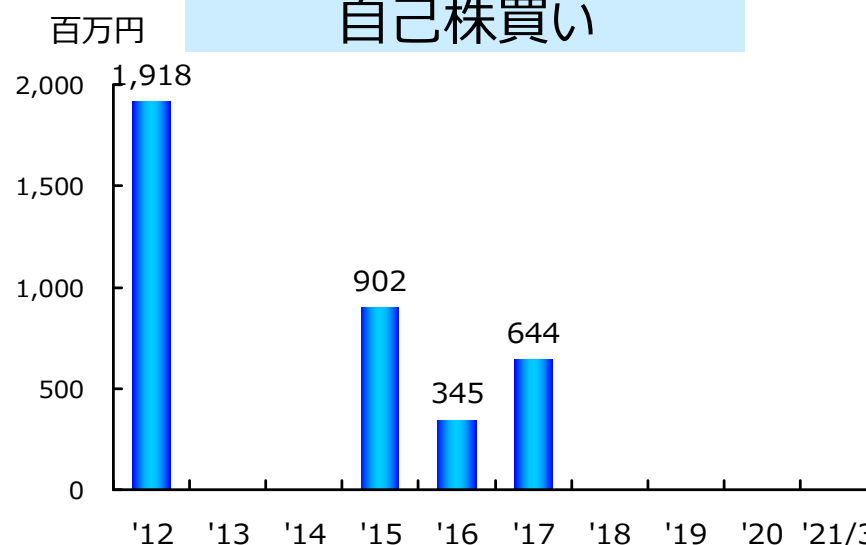
総還元性向・配当性向



1株当たり配当金



自己株買い



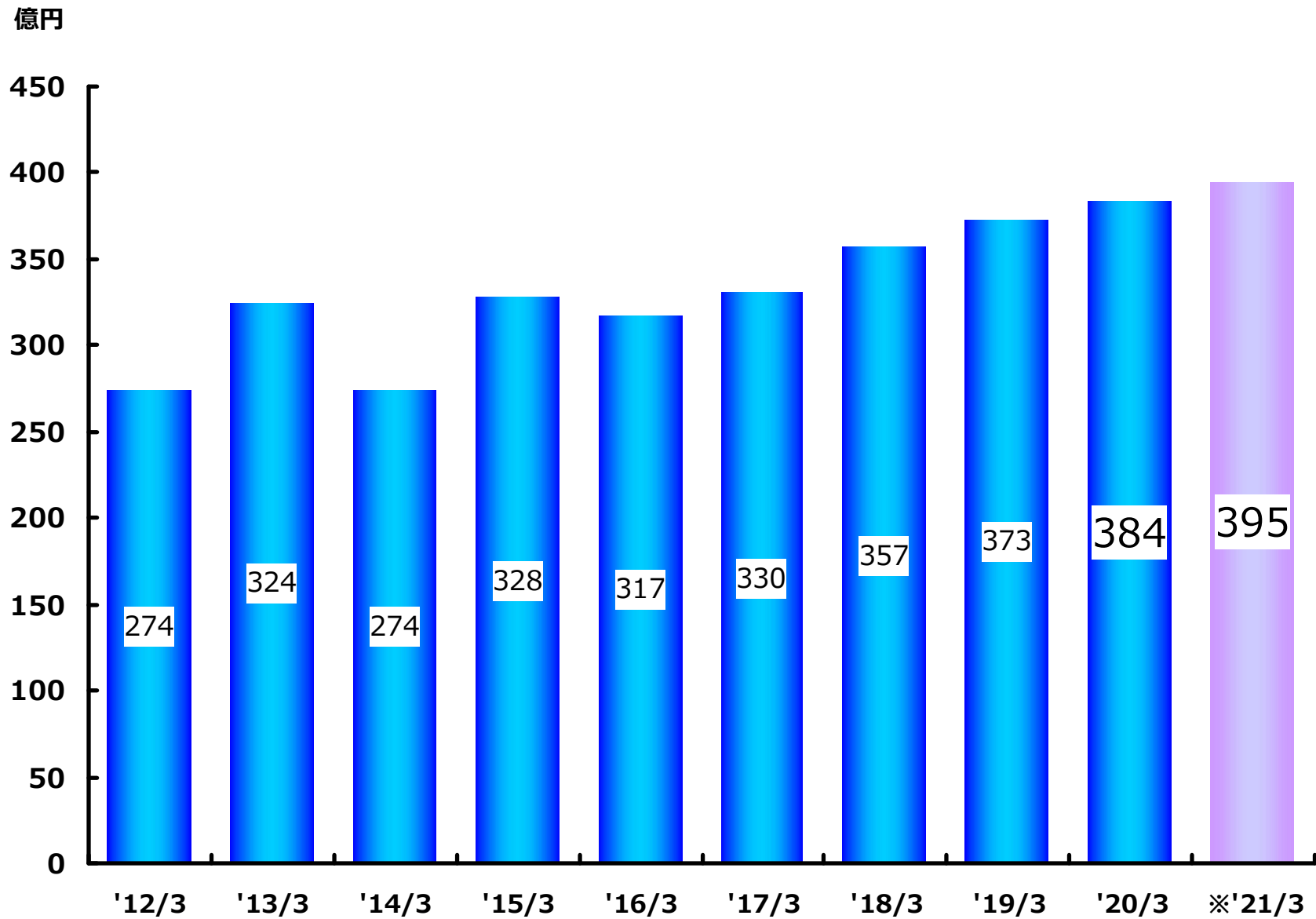
補足説明資料 マーケットデータ等

グループ人員 内訳

(人数)	20年3月期 (3月31日現在)		21年3月期 (9月30日現在)			
	正社員	臨時社員 ※	正社員	臨時社員	前期末増減	
					正社員	臨時社員
フジミインコーポレーテッド	636	192	663	191	+27	△1
フジミコーポレーション	108	1	112	2	+4	+1
フジミ台湾	86	2	93	2	+7	±0
フジミマイクロテクノロジー	66	5	68	5	+2	±0
フジミヨーロッパ	5	2	5	2	±0	±0
フジミ韓国	4	1	4	1	±0	±0
フジミ深圳	3	1	2	1	△1	±0
合 計	908	204	947	204	+39	±0

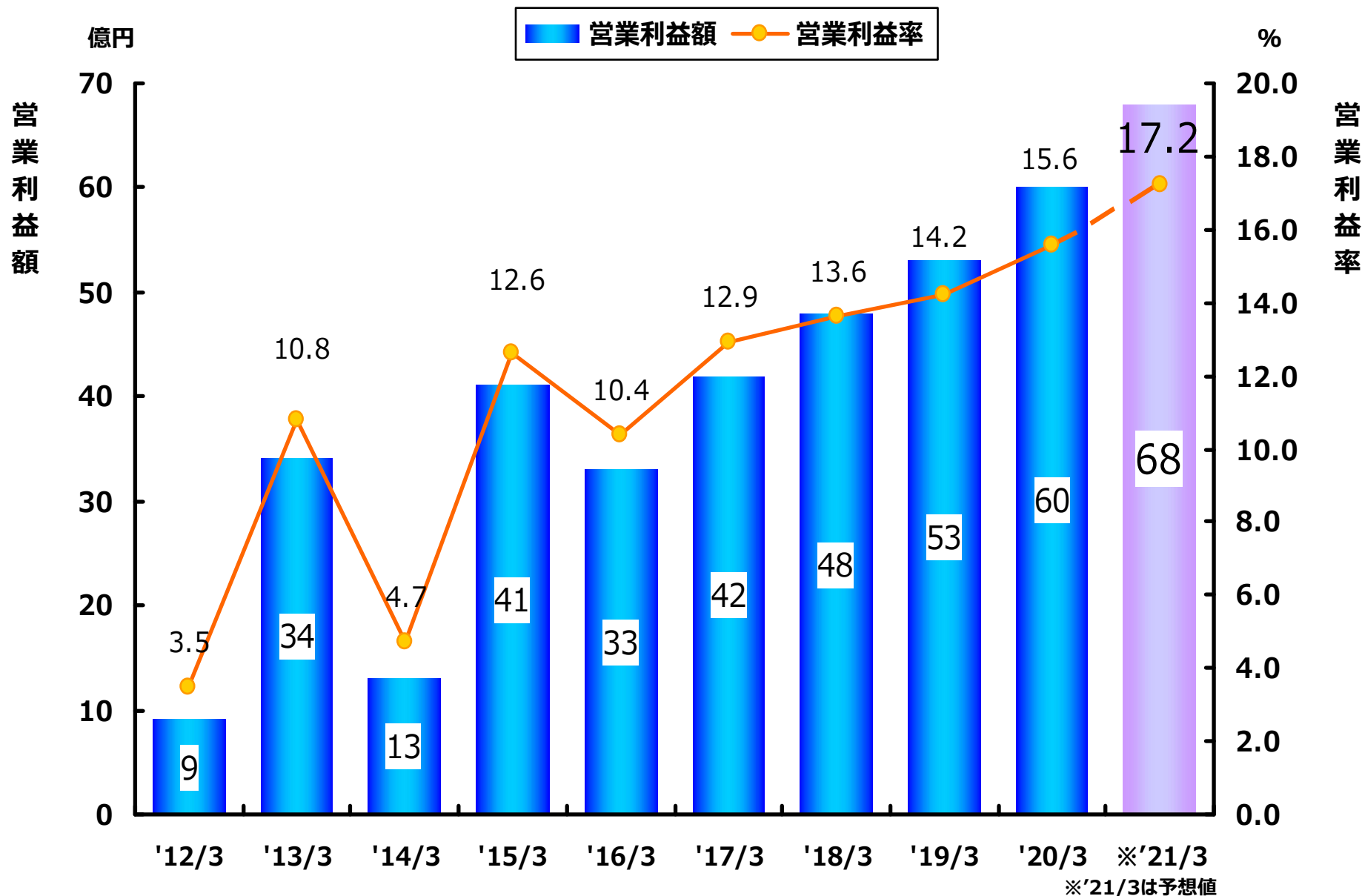
※ 臨時社員（嘱託、パートタイマー、人材会社からの派遣社員）は年間の平均人員

売上高 (通期)

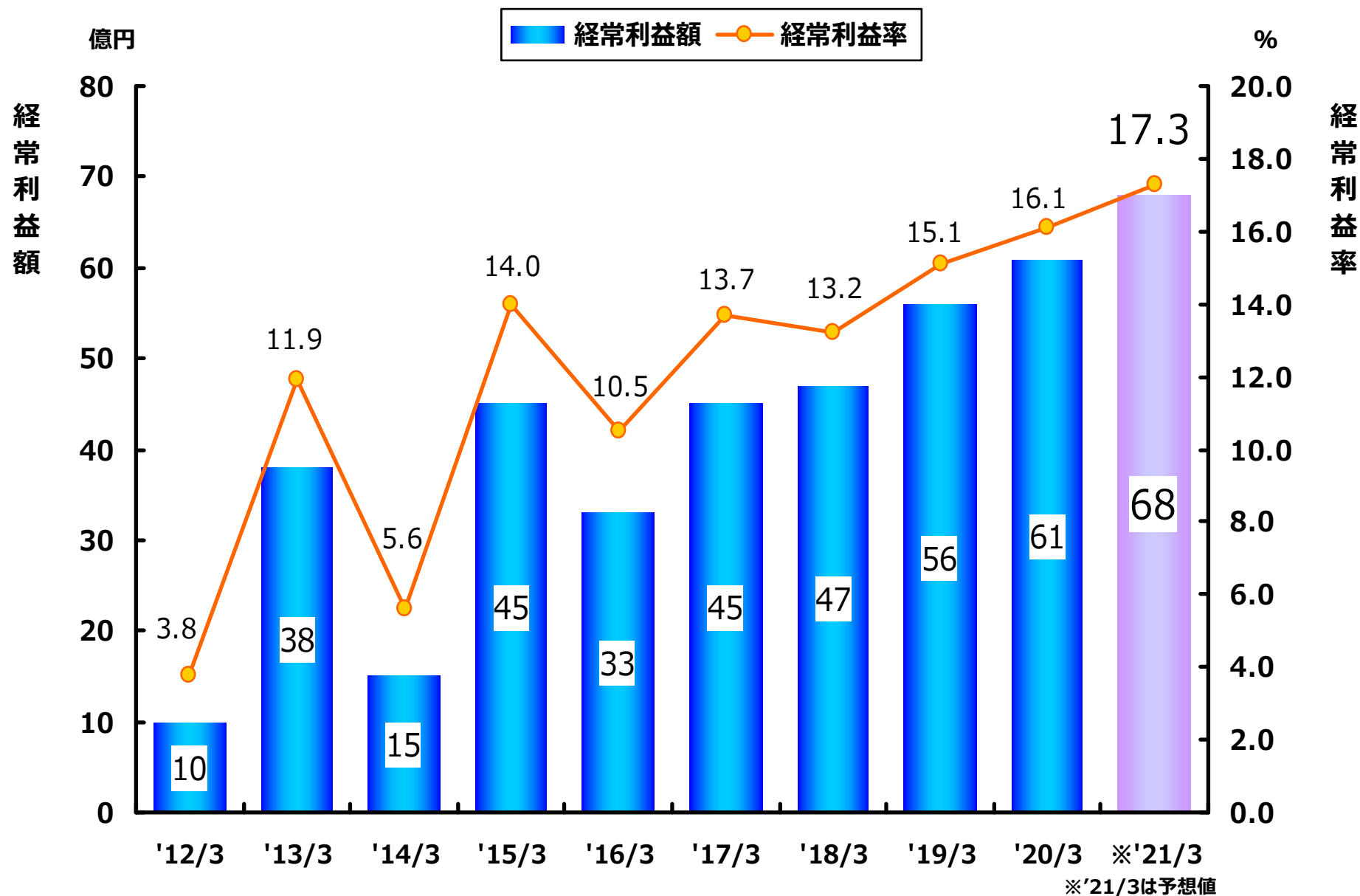


※'21/3は予想値

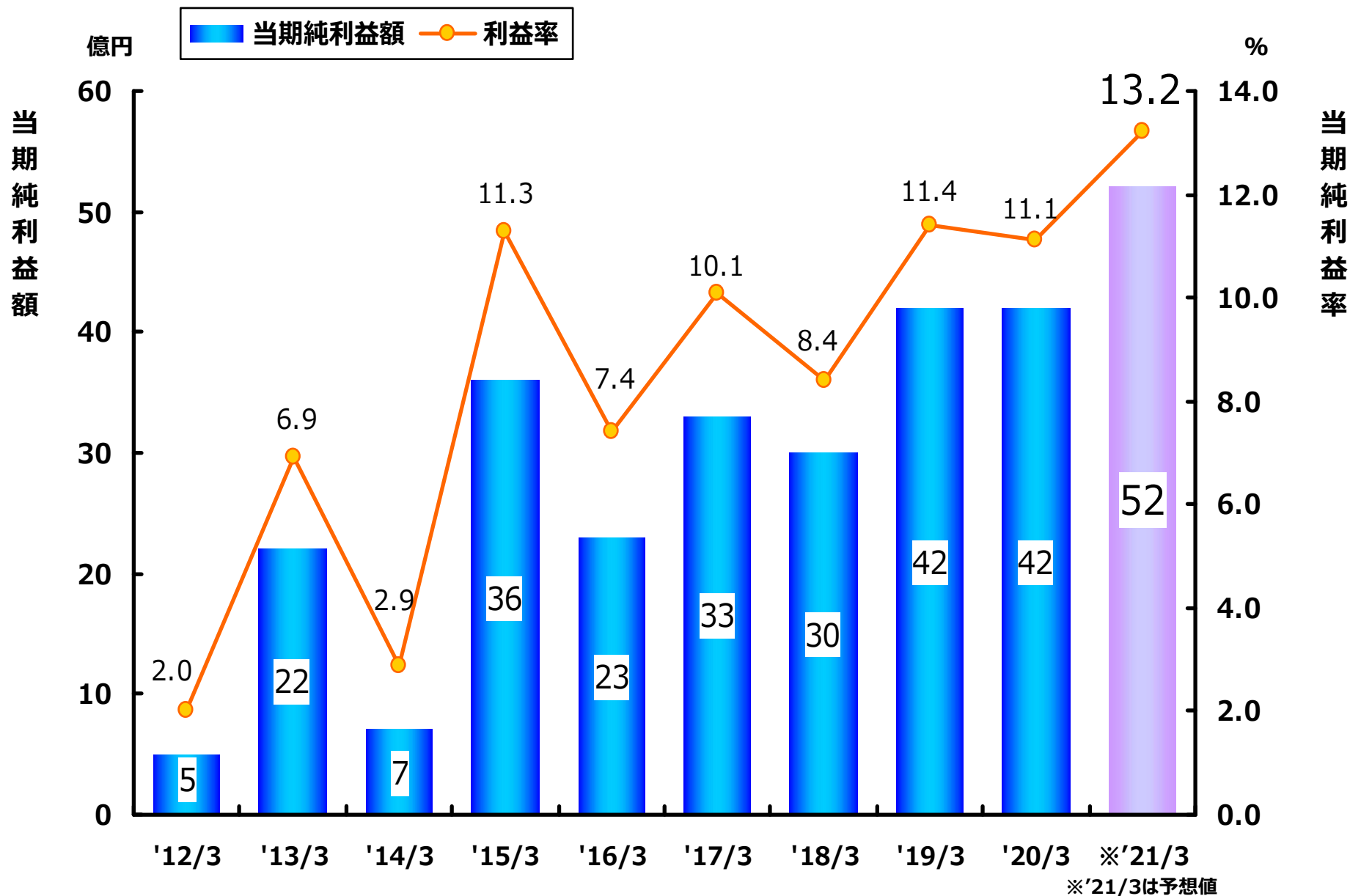
営業利益 (通期)



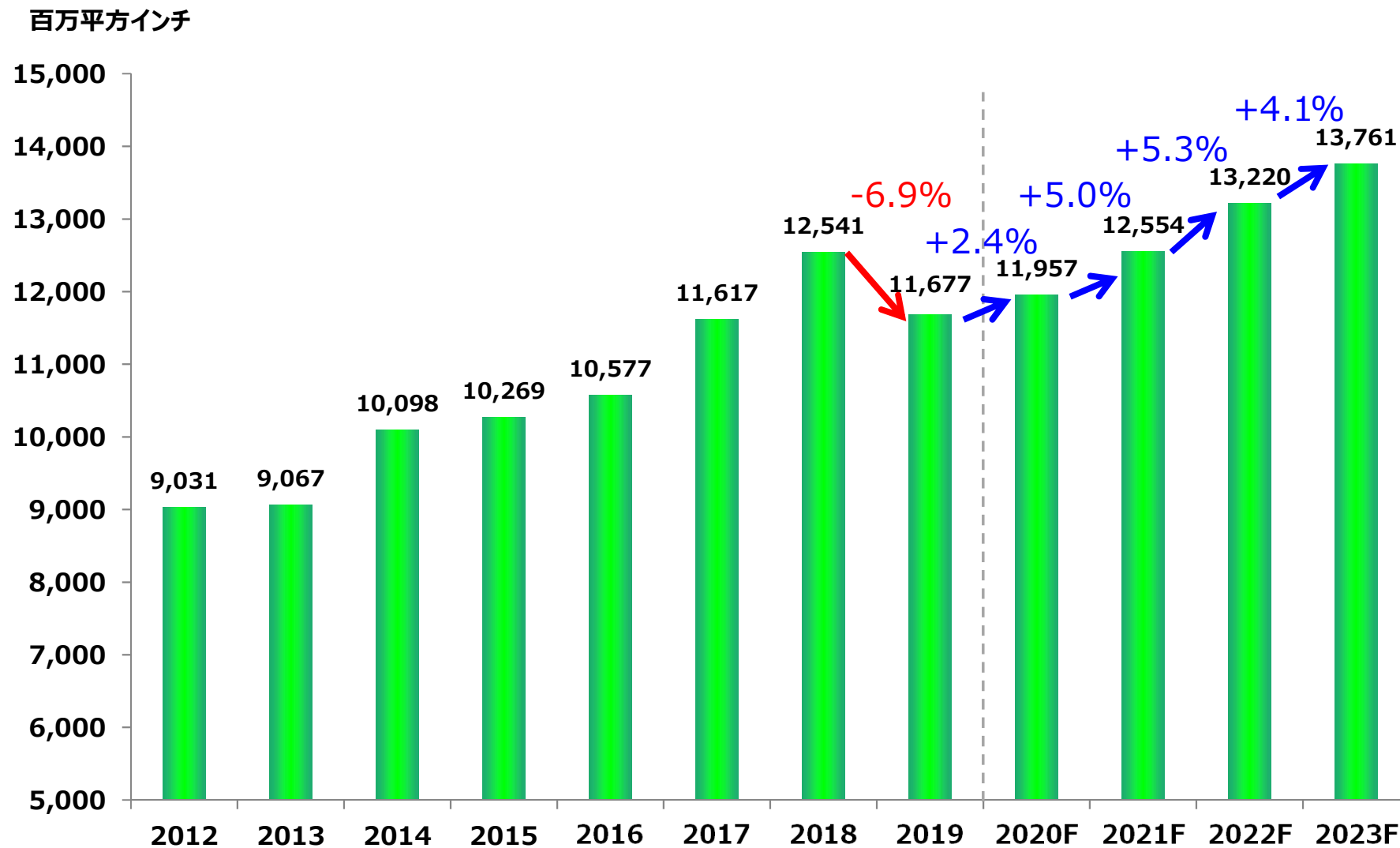
経常利益 (通期)



当期純利益 (通期)

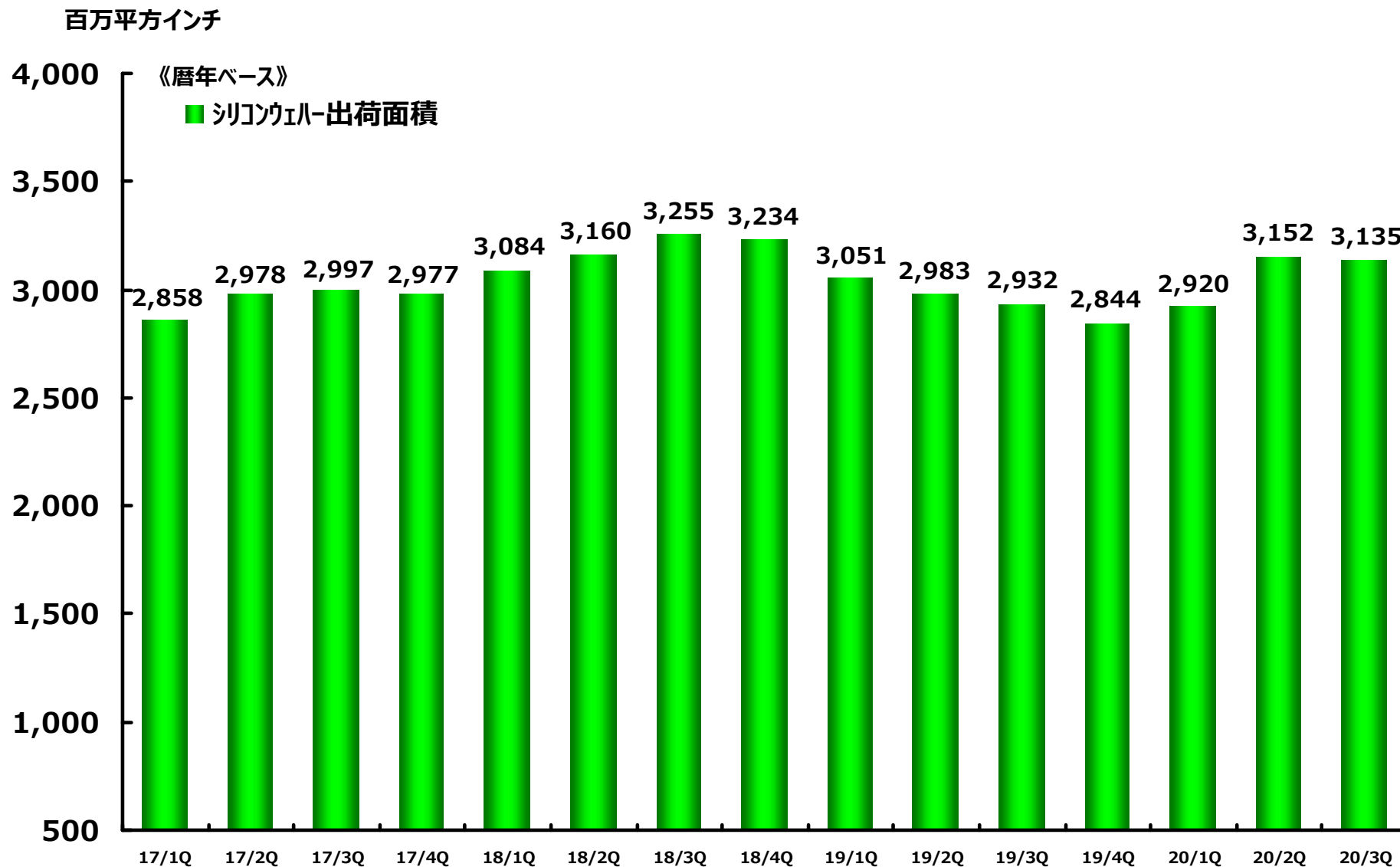


シリコンウェハ需要予測（出荷面積換算 全口径）



出所：SEMI（Semiconductor Equipment and Materials International）

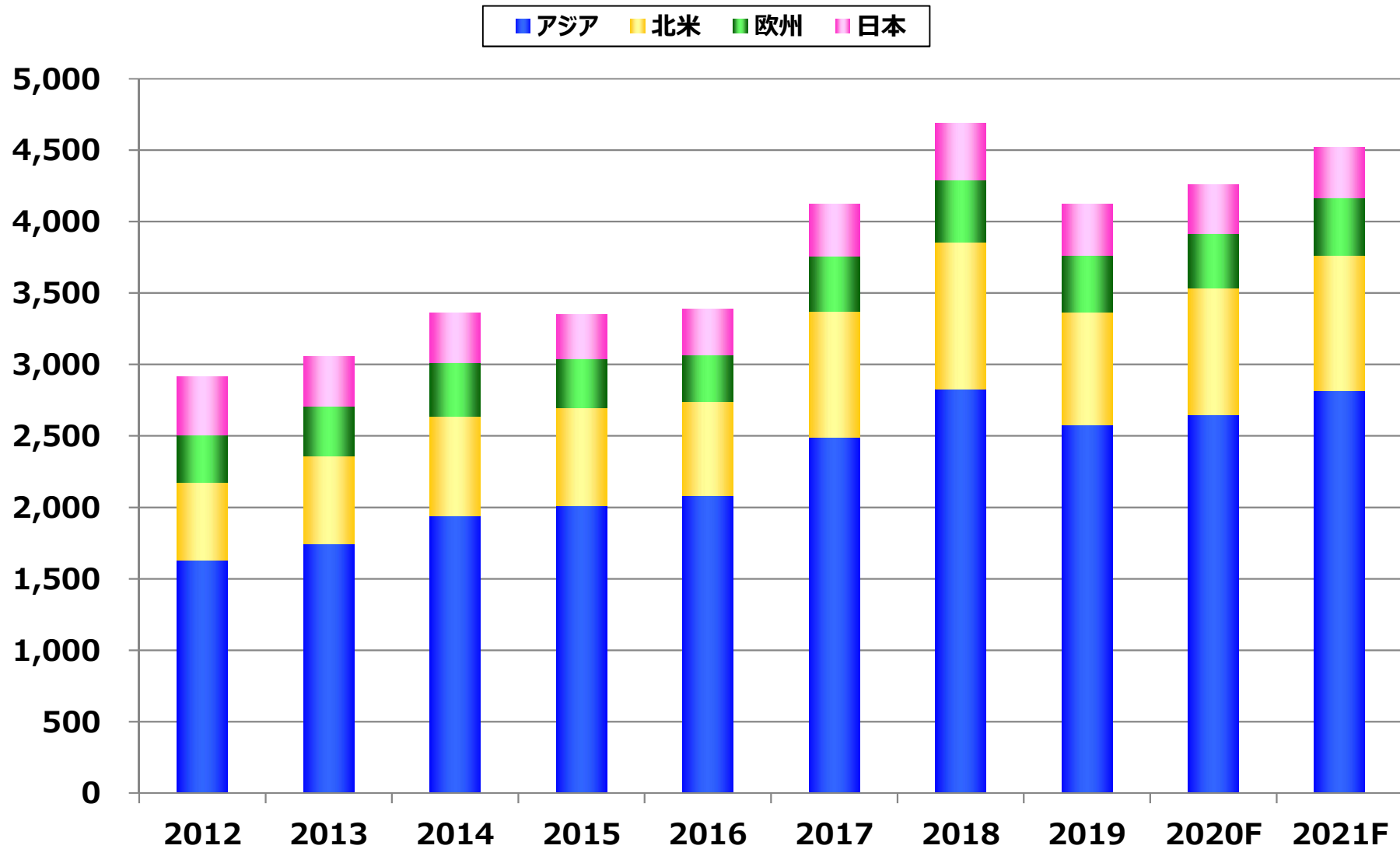
シリコンウェハ-出荷面積 (四半期)



出所：SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International)

半導体市場規模 (地域別)

(単位：億ドル)



出所：世界半導体市場統計 (WSTS) 2020/6/9